



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI XTPL S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ
XTPL S.A.
ZA I PÓŁROCZE 2026**

28/09/2026

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze oraz Inwestorzy,

XTPL od początku swojego istnienia działa w logice globalnej, ponieważ rozwijana przez nas technologia ultraprecyzyjnego druku i dozowania materiałów odpowiada na potrzeby producentów najbardziej zaawansowanej elektroniki, skoncentrowanych przede wszystkim w Azji Wschodniej, Ameryce Północnej i Europie. Zdecydowana większość naszej sprzedaży trafia dziś na rynki zagraniczne, a projekty o największym potencjale przemysłowym prowadzimy z globalnymi partnerami i klientami. W pierwszym półroczu 2026 wykonaliśmy kolejne istotne kroki na drodze do zbudowania w Polsce globalnego dostawcy technologii dla producentów elektroniki nowej generacji. Kontynuowaliśmy pierwsze wdrożenie przemysłowe w Chinach, weszliśmy z technologią UPD na rynek japoński, rozpoczęliśmy współpracę z Manz Asia na Tajwanie, uzyskaliśmy pierwsze zamówienie w ramach nowej linii biznesowej systemów ODRA, a ponadto zabezpieczyliśmy sytuację finansową Spółki.

Najbardziej zaawansowanym przykładem przemysłowego zastosowania technologii XTPL pozostaje wdrożenie realizowane dla jednego z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD w Chinach. Z początkiem roku zakończyliśmy dostawę ostatniej głowicy w ramach pierwszej partii sześciu modułów UPD, które zostały zintegrowane z maszynami pracującymi na liniach produkcyjnych klienta końcowego. Technologia opracowana we Wrocławiu z sukcesem przeszła tym samym drogę z laboratorium do fabryki i została zwalidowana w rzeczywistym środowisku produkcyjnym.

Potwierdzeniem dalszego rozwoju tego projektu jest zamówienie ramowe na kolejnych 10 modułów UPD, które otrzymaliśmy już po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Pokazuje ono, że pierwsze wdrożenie nie ma charakteru jednorazowego, a klient zwiększa skalę wykorzystania naszej technologii. Projekt będzie generował przychody zarówno ze sprzedaży kolejnych modułów, jak i z materiałów eksploatacyjnych, co wspiera rozwój modelu opartego na powtarzalnej sprzedaży. Zamówienie drugiej, większej partii modułów UPD, w naszej ocenie nie wyczerpuje potencjału do dalszych rozszerzeń w przyszłości.

Równocześnie postępują prace w ramach pozostałych projektów przemysłowych, wśród których coraz większego znaczenia nabierają półprzewodniki, w tym obszar advanced packaging oraz zaawansowane obwody drukowane. Jednym z najbardziej istotnych kierunków w pierwszej połowie roku stała się dla nas Japonia. Wejście na ten rynek jest efektem kilkuletniej pracy nad rozwojem technologii, budowaniem jej widoczności oraz zaufania do XTPL wśród lokalnych partnerów i potencjalnych klientów.

W czerwcu otrzymaliśmy pierwsze zamówienie na moduł UPD z Japonii w ramach 4. etapu procesu nakierowanego na docelowe wdrożenie przemysłowe, który będzie wykorzystywany w procesach yield management dla zaawansowanych obwodów HDI i UHDI PCB oraz podłoży dla półprzewodników związanych z obszarem advanced packaging. Szczególne znaczenie ma wykorzystanie w tym projekcie miedzi jako materiału przewodzącego, ponieważ zwiększa to liczbę potencjalnych zastosowań naszej technologii i jednocześnie wspiera rozwój linii High Performance Materials. Moduł UPD testowany w tym projekcie cechuje się również znacznie bardziej rozbudowaną specyfikacją, co przekłada się na blisko dwukrotnie wyższą wartość jednostkową w porównaniu z modułami UPD we wdrożeniu w Chinach.

Już po zakończeniu pierwszego półroczu otrzymaliśmy z Japonii kolejne, niezależne zamówienie, tym razem na urządzenie DPS oraz na system laserowy dla nowego partnera przemysłowego. W połączeniu z kolejnym zamówieniem na moduły UPD do Chin traktujemy te wydarzenia jako konkretne potwierdzenie, że praca

wykonywana nad pipeline w poprzednich okresach stopniowo przekłada się na kolejne decyzje zakupowe klientów.

Naszą obecność w Azji rozwijamy również poprzez strategiczne partnerstwa. W pierwszym półroczu nawiązaliśmy współpracę z Manz Asia, w ramach której urządzenie DPS zostało zainstalowane w centrum partnera na Tajwanie. Pozwala nam to prezentować i testować technologię bliżej potencjalnych klientów z jednego z najważniejszych na świecie ekosystemów półprzewodnikowych. To szybszy i mniej obciążający nasze finanse model niż rozwijamy w Stanach Zjednoczonych, gdzie funkcjonuje dedykowane centrum demonstracyjno-sprzedażowe XTPL w Bostonie.

Drugim ważnym kierunkiem pierwszego półrocza było rozpoczęcie komercjalizacji systemów ODRA, które stanowią czwartą linię biznesową XTPL i wypełniają przestrzeń potrzeb naszych klientów pomiędzy urządzeniami DPS a modułami UPD integrowanymi z dużymi maszynami przemysłowymi. ODRA jest samodzielnym systemem produkcyjnym funkcjonującym w modelu High-Mix Low-Volume, a jego specyfika sprawia, że pojedynczy klient może docelowo potrzebować większej liczby urządzeń.

W marcu otrzymaliśmy pierwsze zamówienie na system ODRA od klienta przemysłowego z Doliny Krzemowej, działającego w obszarze advanced packaging i współpracującego również z sektorem obronnym. Zespół projektowy realizuje kolejne kamienie milowe związane z opracowaniem pierwszego urządzenia, natomiast uzgodniony z klientem termin dostawy i rozliczenia systemu został przesunięty z czwartego kwartału 2026 roku na pierwszy kwartał 2027 roku. To pierwsza sprzedaż nowego produktu XTPL, która stanowić będzie istotną referencję dla kolejnych zainteresowanych odbiorców. Dlatego potrzebujemy więcej czasu na przeprowadzenie kompleksowych testów końcowych, przed wysyłką systemu doklienta.

Równolegle kontynuujemy zaawansowane rozmowy z następnymi potencjalnymi odbiorcami.

Realizacja ambitnego pipeline projektów przemysłowych oraz dalsze skalowanie nowych linii biznesowych wymagają odpowiednio zabezpieczonego zaplecza finansowego. W pierwszym półroczu pozyskaliśmy 19,5 mln PLN brutto w ramach emisji akcji oraz podpisaliśmy umowę na około 10,1 mln PLN dofinansowania z NCBR. Środki te pozwalają nam obecnie finansować projekty przemysłowe, rozwój systemów ODRA, prace badawcze oraz pozostałe linie biznesowe. Jest to element realizacji Strategii XTPL na lata 2026–2028, przy czym równolegle, prowadzimy działania związane z pozyskaniem finansowania dłużnego oraz zagranicznego inwestora strategicznego, tj. inwestora finansowego z Tajwanu, specjalizującego się w obszarze półprzewodników.

W pierwszym półroczu 2026 wygenerowaliśmy 1,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży produktów i usług oraz 3,3 mln PLN przychodów ogółem, wobec odpowiednio 5,1 mln PLN oraz 6,0 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBITDA wyniosła -7,6 mln PLN, a stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił 16,3 mln PLN. Wyniki pierwszego półrocza nie pokazują jeszcze pełnego efektu pracy prowadzonej w ramach rozwijanych projektów przemysłowych, które mają długi cykl sprzedaży i wdrożenia, a ich tempo w dużej mierze zależy od procesów walidacyjnych oraz harmonogramów klientów końcowych, na które XTPL nie ma bezpośredniego wpływu.

Pierwsza połowa 2026 roku przyniosła intensyfikację działań w najważniejszych dla XTPL obszarach, od zakończenia pierwszego etapu wdrożenia w Chinach, przez rozpoczęcie komercjalizacji ODRA i wejście z technologią UPD na rynek japoński, po rozwój obecności na Tajwanie oraz kontynuację prac nad pozostałymi projektami przemysłowymi. Wydarzenia, które nastąpiły już po 30 czerwca, w szczególności kolejne

zamówienie w Japonii oraz druga, większa transza modułów UPD do klienta Chin, pokazują, że część tej pracy zaczyna się materializować.

Z rosnącym zaawansowaniem projektów rozpoczęliśmy drugą połowę 2026 roku i ponownie liczymy na wsparcie historycznej sezonowości, która objawia się zazwyczaj wyższą liczbą zamówień w tym okresie. Będziemy konsekwentnie realizować pozyskane zamówienia i przesuwać kolejne projekty przemysłowe do następnych etapów, mając świadomość, że ich tempo pozostaje w dużej mierze uzależnione od procesów decyzyjnych globalnych klientów. Pierwsze zamówienia pozyskane po zakończeniu półrocza oraz rozwój pipeline dają nam jednak podstawy do pozytywnej oceny kierunku, w którym rozwija się XTPL.

Choć budowanie globalnej spółki deep tech z Polski wymaga czasu, konsekwencji i cierpliwości, technologia XTPL jest dziś obecna w projektach realizowanych w Chinach, Japonii, Tajwanie i Stanach Zjednoczonych, a liczba jej potencjalnych zastosowań systematycznie rośnie. Naszym zadaniem pozostaje przekładanie rosnącej globalnej wiarygodności, zbudowanego pipeline oraz wykonanej pracy na kolejne wdrożenia, zamówienia i wzrost skali sprzedaży.

Na zakończenie tego Listu pragniemy podziękować wszystkim naszym akcjonariuszom za okazane zaufanie. Słowa podziękowania kierujemy również do naszych klientów, partnerów i dostawców wspierających rozwój XTPL na globalnym rynku zaawansowanej elektroniki, a przede wszystkim do naszych pracowników, których wiedza i zaangażowanie umożliwiają nam prowadzenie wymagających projektów z partnerami na całym świecie.

Serdecznie zachęcamy do uważnej lektury raportu za pierwsze półrocze 2026 oraz do pozostawania z nami w kontakcie poprzez dział relacji inwestorskich i organizowane przez nas konferencje wynikowe.

Z poważaniem,



Dr Filip Graneck



Jacek Olszański

1. INFORMACJE O RAPORCIE ORAZ SŁOWNICZEK POJĘĆ I SKRÓTÓW W NIM UŻYTYCH	6
2. WYBRANE DANE FINANSOWE.....	8
3. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	10
4. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	10
5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ ZASAD SPORZĄDZENIA ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	11
6. AKCJONARIAT	50
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	52
8. RAPORT Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	53
9. STANOWISKO ZARZĄDU	54
10. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE FIRMY AUDYTORSKIEJ UPRAWNIONEJ DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	55
11. ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACJI.....	56

1. INFORMACJE O RAPORCIE ORAZ SŁOWNICZEK POJĘĆ I SKRÓTÓW W NIM UŻYTYCH

XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000619674 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („XTPL”, „XTPL S.A.”, „Spółka”, „Jednostka”, „Jednostka Dominująca”, „Emitent”), Numer NIP: 9512394886, REGON: 361898062.

Na 30 czerwca 2026 roku („Dzień Bilansowy”) kapitał zakładowy XTPL S.A. wynosił 294.987,70 zł i składał się z 2.949.877 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje”).

Ten dokument („Raport”) zawiera Sprawozdanie Zarządu XTPL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej XTPL S.A. („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”, „Grupa XTPL”, „Grupa XTPL S.A.”) i z działalności XTPL S.A. za I półrocze 2026 roku („Sprawozdanie z działalności”).

Grupa Kapitałowa obejmuje jednostkę dominującą oraz spółki zależne (XTPL Inc. z siedzibą w USA oraz TPL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu), nad którymi XTPL S.A. sprawuje całkowitą kontrolę („Spółki Zależne”, „Jednostki Zależne”, „XTPL Inc.”, „TPL sp. z o.o.”).

Źródłem danych w Raporcie, o ile nie wskazano inaczej, jest XTPL S.A. Dniem publikacji Raportu („Data Raportu”) jest dzień 28 września 2026 roku.

Przez skonsolidowane sprawozdanie finansowe w Raporcie rozumie się śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (obejmujące Spółkę i Spółki Zależne) za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2026 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych do stosowania w UE. Przez jednostkowe sprawozdanie finansowe w Raporcie rozumie się śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2026 roku („Okres Sprawozdawczy”) sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych do stosowania w UE.

„GPW” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

„KSH” oznacza Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

„Rozporządzenie w sprawie raportów bieżących i okresowych” oznacza Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

„Statut” oznacza statut XTPL S.A. dostępny publicznie pod adresem:

<https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/>

„Ustawa o ofercie publicznej” oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

„Ustawa o rachunkowości” oznacza Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Z uwagi na fakt, iż działalność XTPL S.A. ma dominujący wpływ na działalność Grupy Kapitałowej, informacje zaprezentowane w Sprawozdaniu z działalności odnoszą się zarówno do Spółki XTPL S.A. oraz Grupy Kapitałowej XTPL S.A. o ile nie wskazano inaczej.

Jeżeli nie podano inaczej, dane finansowe prezentowane są w tysiącach.

DEFINICJE

Ω (om) oznacza jednostkę rezystancji (oporu elektrycznego)

$\Omega/\square$ oznacza rezystancję na kwadrat lub inaczej rezystancję powierzchniową

μm oznacza mikrometr, tj. jedną milionową metra (1 / 1 000 000 m)

nm oznacza nanometr, tj. jedną miliardową metra (1 / 1 000 000 000 m)

Adhezja oznacza tendencję różnych materiałów do przylegania do siebie

Aglomeracja cząstek oznacza łączenie drobnych cząstek w większe części

AMOLED (ang. Active-matrix organic light-emitting diode) oznacza diodę OLED z aktywną matrycą

CAD (ang. Computer aided design) oznacza projektowanie wspomagane komputerowo

CAGR oznacza kumulowany roczny wskaźnik wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate) - jest to średni wskaźnik rocznego wzrostu w badanym okresie, przy założeniu, że roczne wzrosty są dodawane do wartości bazy następnego okresu

Depozycja oznacza lokalne osadzanie materiału

Formulacja tuszu oznacza precyzyjną recepturę tuszu, nadającą mu pożądane właściwości fizyko-chemiczne

FHE (ang. Flexible Hybrid Electronics) oznacza układ elektroniczny wykonany na giętkim podłożu zawierający sztywne elementy elektroniczne, tzn. niepodatne na zginanie

FPD (ang. Flat-panel display) oznacza płaski wyświetlacz

IP (ang. Intellectual property) oznacza własność intelektualną i przemysłową

Konduktancja oznacza przewodność elektryczną, będącą odwrotnością rezystancji

Lepkość - własność fizyczna materiałów (płynów) charakteryzująca ich tarcie wewnętrzne podczas przepływu płynu (przykładowo woda jest cieczą mało lepka, o wartości około 1 cP, a miód ma lepkość od 2 000 do 10 000 cP)

Materiał hydrofilowy oznacza skłonność materiału do przyciągania do siebie cząsteczek wody

Materiał hydrofobowy oznacza skłonność materiału do odpychania od siebie cząsteczek wody

Metoda addytywna oznacza dodawanie materiału w celu otrzymania określonej struktury i jest przeciwieństwem metody subtraktywnej polegającej na odejmowaniu materiału w celu otrzymania określonej struktury

mikro-LED (uLED, μ LED) - technologia płaskiego wyświetlacza oparta na półprzewodnikowych diodach elektroluminescencyjnych (LED), w których każdy z pikseli jest diodą LED o mikroskopijnym rozmiarze.

NDA (ang. Non-disclosure agreement) oznacza umowę o zachowaniu poufności

ODR (ang. Open Defect Repair) oznacza naprawę defektów polegających na przerwaniu ścieżki przewodzącej w układzie elektronicznym

OLED (ang. Organic light-emitting diode) oznacza diodę LED bazującą na materiale organicznym.

UPD (ang. Ultra precise dispensing) oznacza technologię ultraprecyzyjnego drukowania struktur rozwijaną przez Spółkę

PCB - płyta drukowana wykonana z materiału izolacyjnego z połączeniami elektronicznymi przeznaczona do montażu podzespołów elektronicznych

Proces spiekania oznacza wzajemne wiązanie się cząstek po podgrzaniu ich do temperatury niższej od potrzebnej do ich stopienia

Proof of concept oznacza jedną z pierwszych faz współpracy polegającej na realizacji pomysłu danego przez klienta w celu udowodnienia jego działania

R&D (ang. Research and Development) oznacza badania i rozwój (B+R)

Rezystancja oznacza opór elektryczny

SEM (ang. Scanning electron microscope) oznacza skaningowy mikroskop elektronowy

Spiekanie Flash oznacza metodę utwardzania materiału z użyciem światła o wysokiej energii w czasie pojedynczych milisekund

TEA (ang. Technology Evaluation Agreement) oznacza umowę o ewaluację technologii

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (w tysiącach złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Spółki i Grupy XTPL S.A.

Zastosowane kursy walut

Pozycje bilansowe przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na Dzień Bilansowy.

Pozycje rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca.

Poniższa tabela zawiera kursy euro zastosowane do przeliczenia danych niniejszego sprawozdania.

Kursy walut zastosowane w sprawozdaniu finansowym	2026 styczeń - czerwiec		2025 styczeń - czerwiec/ grudzień	
	EUR	USD	EUR	USD
dla pozycji bilansowych	4,2963	3,7708	4,2267	3,6016
dla pozycji wynikowych i przepływów pieniężnych	4,2522	3,6526	4,2208	3,8422

2.1 Wybrane jednostkowe dane finansowe

Dane w tys.	1 stycznia - 30 czerwca 2026		1 stycznia - 30 czerwca 2025	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 518	357	5 809	1 376
Przychody z tytułu dotacji	1 777	418	871	206
Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 197	-752	-2 739	-649
Zysk (strata) brutto	-10 513	-2 472	-11 124	-2 636
Zysk (strata) netto	-10 513	-2 472	-11 124	-2 636
Amortyzacja	3 468	816	2 754	652
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 176	-1 453	-11 667	-2 764
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 354	-318	-416	-99
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	16 795	3 950	-482	-114

Dane w tys.	30 czerwca 2026		31 grudnia 2025	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Kapitał (fundusz) własny	29 388	6 840	21 377	5 058
Zobowiązania krótkoterminowe	9 829	2 288	10 351	2 449
Zobowiązania długoterminowe	15 051	3 503	17 120	4 050
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 628	3 637	6 363	1 505
Należności krótkoterminowe	5 669	1 319	7 462	1 765
Należności długoterminowe	1 185	276	1 232	291

2.2 Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Dane w tys.	1 stycznia - 30 czerwca 2026		1 stycznia - 30 czerwca 2025	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 518	357	5 132	1 216
Przychody z tytułu dotacji	1 777	418	871	206
Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 195	-751	-3 119	-739
Zysk (strata) brutto	-11 846	-2 786	-12 805	-3 034
Zysk (strata) netto	-11 846	-2 786	-12 808	-3 035
Amortyzacja	3 493	821	2 779	658
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 722	-1 346	-10 973	-2 600
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 369	-322	-436	-103
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	16 761	3 942	-482	-114

Dane w tys. Kapitał (fundusz) własny	30 czerwca 2026		31 grudnia 2025	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Kapitał (fundusz) własny	26 130	6 082	19 403	4 591
Zobowiązania krótkoterminowe	10 835	2 522	10 482	2 480
Zobowiązania długoterminowe	15 049	3 503	17 120	4 050
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 312	3 797	6 642	1 571
Należności krótkoterminowe	2 283	531	4 888	1 157
Należności długoterminowe	1 012	236	1 002	237

3. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z notami uzupełniającymi zostało sporządzone w odrębnym dokumencie: „Śródroczne skrócone jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2026 roku XTPL S.A. oraz Grupy Kapitałowej XTPL S.A.”.

4. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z notami uzupełniającymi zostało sporządzone w odrębnym dokumencie: „Śródroczne skrócone jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2026 roku XTPL S.A. oraz Grupy Kapitałowej XTPL S.A.”.

5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ ZASAD SPORZĄDZENIA ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5.1 Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma):	XTPL Spółka Akcyjna
Siedziba:	Wrocław, Polska
Adres	Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Polska
Kraj	Polska
KRS	0000619674
NIP	9512394886
REGON	361898062
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
Miejsce rejestracji:	Polska
Kapitał zakładowy:	294.987,70 PLN wpłacony w całości
Numer telefonu:	+48 71 707 22 04
Adres internetowy:	www.xtpl.com
E-mail:	investors@xtpl.com

Spółka posiada status spółki publicznej (giełdowej), której akcje notowane są od dnia 20 lutego 2019 roku na rynku regulowanym (równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ticker GPW	XTP
ISIN	PLXTPL000018
Liczba akcji	2 949 877
Free Float	44,62%
Indeksy	WIG, WIGTECH, INNOVATOR, WIGtechTR, WIG-Poland, GPWB-CENTR oraz CEEplus.

Od marca 2020 Spółka jest także notowana na Open Market przy Deutsche Börse we Frankfurcie (ticker FRA: 5C8). W zakresie sprawozdawczości finansowej Grupa Kapitałowa i Spółka stosują zasady MSR/MSSF. Rok obrotowy Spółki i Grupy Kapitałowej trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

5.2 Historia Spółki

Rok	Kamień milowy	Znaczenie strategiczne
2015-2016	Założenie firmy XTPL we Wrocławiu i wstępne opracowanie koncepcji UPD	Stworzenie naukowych i inżynierskich podstaw druku addytywnego z rozdzielczością poniżej jednego mikrometra. Wyznaczenie długoterminowego kierunku działalności firmy w zakresie produkcji mikroelektroniki o wysokiej precyzji.
2017-2018	Wstępna walidacja zasady depozycji oraz pierwsze autorskie konstrukcje dysz i receptury tuszów	Wykazano wykonalność ultraprecyzyjnej addytywnej depozycji i potwierdzono różnicę w stosunku do konwencjonalnego druku i litografii. XTPL zyskało pozycję

Rok	Kamień milowy	Znaczenie strategiczne
		organizacji badawczo-rozwojowej zajmującej się zaawansowanymi technologiami.
2017	IPO i debiut na New Connect	Wejście w ekosystem umożliwiający finansowanie technologicznego start up.
2019	Debiut na rynku regulowanym (równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie	Dostęp do szerokiego rynku umożliwiający finansowanie rozwoju biznesu oraz prac badawczych.
2020	Pierwsza transakcja sprzedaży autorskiego produktu - tuszu przewodzącego, opartego na nanocząstkach srebra	Dostawa zrealizowana dla jednego z partnerów działających w pierwszym komercjalizowanym przez XTPL polu aplikacyjnym, w sektorze wyświetlaczy, pozwala Spółce zaistnieć na rynku jako dostawca komercyjny.
2020	Wprowadzenie na rynek systemu Delta Printing System (DPS)	Pierwszy komercyjny produkt hardware firmy. Umożliwia globalnym instytucjom badawczym wdrożenie technologii UPD do badań w zakresie mikrofabrykacji i tworzenia prototypów. Zapewnia wczesne przychody i globalną rozpoznawalność.
2020-2021	Pierwsze sprzedaże i wdrożenia systemów DPS w Europie, Azji i Ameryce Północnej; rosnąca liczba publikacji naukowych odnoszących się do materiałów i procesów XTPL	Tworzy rozproszony ekosystem naukowców i pierwszych użytkowników. Zapewnia zewnętrzną weryfikację technologii i przyspiesza odkrywanie nowych zastosowań. Poszerza zasięg komercyjny.
2021-2022	Strategiczne ukierunkowanie na zastosowania przemysłowe w dziedzinie wyświetlaczy, opakowań półprzewodników i elektroniki HDI	Wprowadza ustrukturyzowany model współpracy z klientami (wykonalność - walidacja - prototyp - wdrożenie przemysłowe). Wzmacnia koncentrację na rynkach przemysłowych o wysokiej wartości.
2022	Umowa z notowaną na NASDAQ izraelską firmą Nano Dimension Ltd. w zakresie opracowania specjalnej formułacji tuszu do rynku drukowanych płytek PCB oraz Additively Manufactured Electronics (AME).	Wzmacnia pozycję XTPL na rynku jako dostawcy autorskich rozwiązań w obszarze High Performance Materials.
2022	Publikacja wyników badań nad technologią UPD w czasopiśmie „Scientific Reports”, wykazując możliwość drukowania z dokładnością do jednego mikrometra na różnych etapach procesu i na złożonych topografiach	Zweryfikowany przez ekspertów dowód wydajności na poziomie przemysłowym w kontekście mikroelektroniki. Zwiększa to wiarygodność firmy wśród czołowych producentów i integratorów sprzętu.
2022	Sprzedaż pierwszego modułu UPD do integracji przemysłowej w prototypie przemysłowego urządzenia do zastosowań	Przejęcie do etapu ścisłej współpracy Spółki z Partnerem, nakierowanej na opracowanie i wdrożenie przemysłowe urządzenia na linie produkcyjne u wiodącego globalnego producenta elementów półprzewodnikowych na Tajwanie,

Rok	Kamień milowy	Znaczenie strategiczne
	w produkcji półprzewodników dla Partnera z Tajwanu	potwierdza atrakcyjność rozwiązania technologicznego Spółki i potencjał komercjalizacyjny technologii XTPL w ramach linii biznesowej modułów drukujących do integracji przemysłowej.
2023	Publikacje w czasopismach „Advanced Functional Materials” i „ACS Omega” pokazujące znaczenie technologii UPD dla tranzystorów OFET i elastycznych diod QLED	Rozszerza znaczenie technologiczne poza wyświetlacze na półprzewodniki i drukowaną optoelektronikę. Wzmacnia referencje w zakresie materiałów i procesów.
2023-2024	Przejęcie wielu projektów przemysłowych do zaawansowanych etapów walidacji (Korea, Chiny, Tajwan, USA)	Potwierdza popyt w różnych regionach. Wykazuje możliwość zastosowania w naprawie wyświetlaczy, zaawansowanym pakowaniu i połączeniach o wysokiej gęstości. Przygotowuje do wdrożenia na skalę przemysłową.
2024	Utworzenie Centrum Demonstracyjnego XTPL w Bostonie	Dedykowane centrum dla klientów z Ameryki Północnej. Zwiększa możliwości wsparcia dla instytucji badawczo-rozwojowych i partnerów przemysłowych. Rozszerza globalny zasięg komercyjny.
2025	Pierwsze wdrożenie przemysłowe: zamówienie na sześć modułów UPD od dużego globalnego producenta wyświetlaczy (przychody >20 mld USD)	Oznacza przejście od działalności skoncentrowanej na badaniach i rozwoju do wdrożeń przemysłowych. Stanowi kluczową instalację referencyjną, umożliwiającą przyspieszenie realizacji kolejnych projektów przemysłowych.
2025	Rozszerzenie portfela projektów przemysłowych do jedenastu aktywnych przedsięwzięć na głównych rynkach elektronicznych	Wzmacnia dynamikę rozwoju przemysłowego i świadczy o rosnącym zainteresowaniu klientów. Tworzy podstawy do skalowania działalności w wielu lokalizacjach i w wielu liniach produkcyjnych.
2025	Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do podmiotu z sektora obronnego (defence contractor) w USA	Otwiera istotny, specyficzny rynek o wysokim potencjale wzrostu w kontekście sytuacji geopolitycznej.
2026	Zawarcie partnerstwa strategicznego z Manz Asia na Tajwanie	Wejście do centrum innowacji półprzewodnikowych na Tajwanie oraz rozszerzenie sieci dystrybucji na Tajwanie i w Indiach.
2026	Pierwsza sprzedaż systemu ODRA do klienta przemysłowego obsługującego obszar półprzewodnikowy w sektorach obronnym i AI w USA	Wypełnia niszę między urządzeniami laboratoryjnymi DPS (Delta Printing System) a przemysłowymi modułami UPD. Samodzielnie operujący system przeznaczony jest do produkcji przemysłowej High-Mix, Low-Volume (HMLV), tj. zróżnicowanej produkcji w małych seriach.
2026	Zamówienie ramowe na 10 modułów UPD w obszarze technologii nowoczesnych wyświetlaczy (FPD) w ramach kontynuacji	Potwierdza kontynuację współpracy z globalnym producentem wyświetlaczy w ramach wieloletniego projektu wdrożeniowego.

Rok	Kamień milowy	Znaczenie strategiczne
	pierwszego wdrożenia przemysłowego technologii XTPL	
2026 - obecnie	Konsolidacja pozycji jako dostawcy precyzyjnej technologii addytywnej w branżach wyświetlaczy, półprzewodników, płytek drukowanych i elektroniki elastycznej	Przygotowuje firmę XTPL do dalszego rozwoju. Integruje sprzęt, materiały i know-how w zakresie procesów w spójną platformę dostosowaną do długoterminowych trendów branżowych.

5.3 Opis działalności

XTPL to spółka deep tech, zajmująca się komercjalizacją technologii Ultra-Precise Dispensing (UPD) - autorskiej platformy do addytywnego nanodruku, która umożliwia nakładanie materiałów funkcjonalnych w skali mikrometrowej przy użyciu past i tuszów o ultra wysokiej lepkości. Spółka zajmuje się rozwiązaniem kluczowego wąskiego gardła w produkcji elektroniki nowej generacji, gdzie konwencjonalne metody fotolitografii, łączenia drutowego oraz drukowania opartego na kropkach osiągają fundamentalne ograniczenia techniczne, ekonomiczne i związane ze zrównoważonym rozwojem. Technologia XTPL umożliwia bezmaskowe, selektywne i trójwymiarowe nakładanie materiałów na złożone podłoża, otwierając drogę do nowych urządzeń w zakresie wyświetlaczy, zaawansowanego mikromontażu półprzewodników oraz produkcji mikro-LED.

Technologia: Ultra-Precise Dispensing to opatentowany, napędzany ciśnieniem proces umożliwiający drukowanie elementów o rozmiarach do 1 μm przy jednoczesnej obsłudze materiałów o lepkości do >2 500 000 cP i zawartości metalu na poziomie 85–87%. Proces ten przebiega bez konieczności stosowania pomieszczeń czystych, pól elektrycznych ani fotomasek i umożliwia drukowanie 3D na stopniach, rowkach, krawędziach i innych heterogenicznych bądź zakrzywionych powierzchniach.

Propozycja wartości: XTPL łączy precyzję poniżej 10 μm , niezwykłą wszechstronność materiałową oraz prawdziwe możliwości 3D w jednym, sprawdzonym w produkcji procesie addytywnym. Klienci zyskują dzięki niższym nakładom inwestycyjnym w porównaniu z fotolitografią, 80-90-procentowej redukcji odpadów materiałowych, szybszym cykлом rozwoju oraz możliwości przeprowadzania lokalnych napraw i ulepszeń, niemożliwych do wykonania przy użyciu dotychczasowych metod.

5.4 Władze Emitenta

Zarząd

Na Dzień Bilansowy Zarząd pełnił obowiązki w następującym składzie:

- Dr Filip GrANEK - Prezes Zarządu,
- Jacek Olszański - Członek Zarządu.

W dniu 30 czerwca 2026 roku, w związku z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Emitenta i grupy kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2025, wygasły mandaty dotychczasowych Członków Zarządu.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 czerwca 2026 roku powołała Zarząd nowej kadencji w składzie:

- Filip GrANEK - Prezes Zarządu;
- Jacek Olszański - Członek Zarządu.

Na Dzień Raportu Zarząd pełnił obowiązki w tym samym składzie

Rada Nadzorcza

Na Dzień Bilansowy Rada Nadzorcza (RN) pełniła obowiązki w następującym składzie:

- Dr Wiesław Rozłucki - Przewodniczący RN, niezależny Członek RN,
- Dr hab. Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczący RN,
- Beata Turlejska - Członek RN,
- Piotr Lembas - niezależny Członek RN,
- Prof. dr hab. Herbert Wirth - niezależny Członek RN.

W dniu 30 czerwca 2026 roku, w związku odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, wygasły mandaty obecnych Członków Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze powyższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2026 roku podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na liczbę 5 członków oraz powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:

- Wiesław Rozłucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- Beata Turlejska - Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Lembas - Członek Rady Nadzorczej;
- Herbert Wirth - Członek Rady Nadzorczej.

Na Dzień Raportu Rada Nadzorcza pełniła obowiązki w tym samym składzie

Komitet Audytu:

Na Dzień Bilansowy Komitet Audytu (KA) pełnił obowiązki w następującym składzie:

- Piotr Lembas - Przewodniczący Komitetu Audytu, niezależny Członek KA,
- Dr Wiesław Rozłucki - Członek Komitetu Audytu, niezależny Członek KA,
- Prof. dr hab. Herbert Wirth - Członek Komitetu Audytu, niezależny Członek KA.

W dniu 30 czerwca 2026 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała Członków Komitetu Audytu nowej kadencji w składzie:

- Piotr Lembas - Przewodniczący Komitetu Audytu, niezależny Członek KA,
- Dr Wiesław Rozłucki - Członek Komitetu Audytu, niezależny Członek KA,
- Prof. dr hab. Herbert Wirth - Członek Komitetu Audytu, niezależny Członek KA.

Na Dzień Raportu Komitet Audytu pełnił obowiązki w tym samym składzie

Organy zarządzające i nadzorujące w Grupie Kapitałowej

Dane o członkach Zarządu spółki zależnej XTPL Inc.

Zarząd został powołany 24 listopada 2023 r.

Kadencja Zarządu jest wspólna i czas kadencji jest nieokreślony

W okresie od dnia 1 stycznia 2026 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku w skład Zarządu wchodził:

- Filip Graneł - President and CEO, Treasurer
- Urs Berger – Secretary
- Stan Lewandowski - Assistant Secretary

Skład Zarządu do dnia sporządzenia Raportu pozostał bez zmian.

Dane o członkach Zarządu spółki zależnej TPL Sp. z o.o.

Zarząd został powołany 10 maja 2024 r.

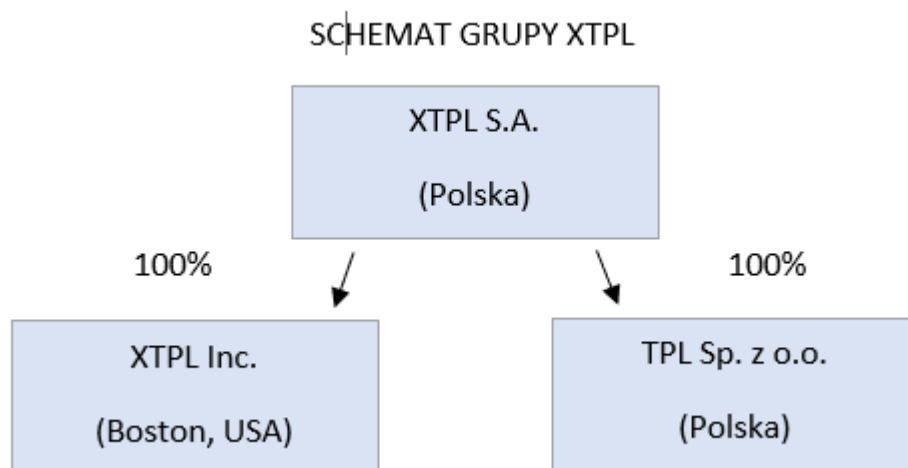
W okresie od dnia 1 stycznia 2026 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku w skład Zarządu wchodził:

- Jacek Olszański - Prezes Zarządu

Skład Zarządu do dnia sporządzenia Raportu pozostał bez zmian.

5.5 Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej

Struktura grupy kapitałowej XTPL S.A. na Datę Raportu jest następująca:



Dane spółki zależnej XTPL Inc.

Nazwa (firma):	XTPL Inc.
Kraj:	Stany Zjednoczone
Siedziba	Boston
Adres:	Greentown Labs 444 Somerville Ave Somerville, MA 02143 USA
NIP:	001726856

Dane spółki zależnej TPL Sp. z o.o.

Nazwa (firma):	TPL Sp. z o.o.
Kraj:	Polska
Siedziba	Wrocław
Adres:	Siedziba Spółki mieści się we Wrocławiu ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, Poland
Numer KRS:	0000553991
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Wrocław - Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	361312719
NIP:	8943061516

5.6 Opis zmian organizacji Grupy Kapitałowej

Nie dotyczy. W Okresie Sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany organizacji Grupy Kapitałowej.

5.7 Oddziały

Nie dotyczy. Jednostka Dominująca ani Spółka Zależna nie posiadają oddziałów.

5.8 Produkty, model biznesowy, strategia i perspektywy rozwoju

Spółka generuje przychody ze sprzedaży autorskich produktów:

- Urządzenie Ultra-Precise Dispensing System (UPD)

Rozwijana przez Emitenta linia produktowa UPD System stanowi modularne urządzenia do dyspensingu UPD przeznaczone do integracji z systemami przemysłowymi, dzięki czemu integratorzy przemysłowi i klienci końcowi mogą korzystać z możliwości drukowania struktur funkcjonalnych o wysokiej rozdzielczości i gęstości upakowania. Te innowacyjne moduły drukujące z kompatybilnymi nanotuszami pozwalają na ultraprecyzyjne tworzenie linii przewodzących na wybranym podłożu technologicznym klienta w aplikacjach nisko i wielkoseryjnych. UPD System integruje wszystkie funkcje wymagane przez technologię ultraprecyzyjnego dyspensingu XTPL® wraz ze sterowaniem elektronicznym i autorskim pakietem oprogramowania XTPL® UPD Process Control Software. Poza znacznym zainteresowaniem rynku odnośnie waluacji rozwiązania typu UPD System XTPL prowadzi zaawansowane rozmowy w zakresie komercjalizacji rozwiązań UPD System z trzema globalnymi producentami elektroniki użytkowej (w Europie, Korei Południowej i USA) oraz pięcioma integratorami przemysłowymi i producentami maszyn przemysłowych (na Tajwanie, w Korei Południowej, w Chinach i USA).

Spółka na Dzień Raportu sprzedała i dostarczyła 13 produktów linii UPD

- Urządzenie Delta Printing System (DPS)

Delta Printing System to samodzielny system badawczo- rozwojowy i prototypowy, który umożliwia sprawdzenie możliwości technologii UPD opracowanej przez XTPL na różnych podłożach i z użyciem nanotuszków Emitenta. Zadaniem urządzenia jest również promocja technologii Emitenta wśród światowych liderów opinii branży wysokich technologii - w tym wśród najlepszych ośrodków akademickich, naukowych oraz instytutów R&D producentów elektroniki. Komercjalizacja tej linii biznesowej przez Emitenta rozpoczęła się na przełomie 2020 i 2021.

Spółka na Dzień Raportu sprzedała i dostarczyła 46 produktów linii DPS.

- High-Performance Materials (HPM)

Od czasu rozpoczęcia komercjalizacji nanotuszków opracowanych przez wewnętrzny dział R&D Spółki, linia materiałów XTPL jest rozwijana jako komplementarna, a jednocześnie niezależna linia biznesowa. W tym czasie Spółka zanotowała znaczący wzrost działań w zakresie oferowanych nanotuszków, wzrost bazy klientów oraz rosnące wyniki sprzedażowe. Oferta tej jednostki biznesowej obejmuje zarówno nanopasty elektrycznie przewodzące o unikatowej formule umożliwiające pełne wykorzystanie potencjału metody PD, jak również linie tuszów i past na bazie nanocząstek srebra skierowanych do użytku w innych technologiach druku, takich jak inkjet printing, LIFT (Laser Induced Forward Transfer), druk aerozolowy (z systemami pneumatycznymi) czy micro-dispensing.

Spółka na Dzień Raportu sprzedała produkty linii HPM w ramach 123 transakcji 375 od początku komercjalizacji nanotuszków - HPM z regionów EMEA, USA i Azji, do klientów w 23 krajach, zyskując zaufanie 81 powracających klientów.

W 2025 r. Emitent w ramach portfolio produktowego oferował w ramach linii HPM nowy innowacyjny produkt: pastę elektrycznie przewodzącą na bazie nanocząstek złota. W ten sposób oferta XTPL obejmuje obecnie tusze i pasty oparte o dwa różne rodzaje nanocząstek metalicznych: srebra i złota.

- Urządzenie ODRA

Urządzenie ODRA (wcześniej znane pod roboczą nazwą DPS+) tworzy czwartą linię biznesową XTPL, wypełniającą niszę między urządzeniami laboratoryjnymi DPS (Delta Printing System), a przemysłowymi

modułami UPD. Samodzielnie operujący system przeznaczony jest do produkcji przemysłowej High-Mix, Low-Volume (HMLV), tj. zróżnicowanej produkcji w małych seriach.

Kluczowe cechy ODRA:

1. Potencjał powtarzalnych zamówień: użytkownicy profesjonalni z reguły potrzebują więcej niż jednego systemu ODRA, co odróżnia tę linię od DPS (1 urządzenie na klienta);
2. Profil użytkownika: klienci przemysłowi, kontrahenci sektora obronnego w odróżnieniu od DPS (laboratoria, instytuty naukowe, R&D).

MODEL BIZNESOWY:

- **LICENCJONOWANIE:** Spółka opracowuje przystosowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie technologiczne, które licencjonuje partnerowi, tworzącemu na jej bazie urządzenia umożliwiające zastosowanie technologii w przemyśle. Przychodem Spółki w tym przypadku są opłaty licencyjne bazujące na sprzedaży urządzeń, w których wdrożono opracowaną technologię.

- **PARTNERSTWO STRATEGICZNE I UMOWY DYSTRYBUCJI:** Spółka opracowuje przystosowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie technologiczne i komercjalizuje je we współpracy z partnerem strategicznym, z którym zawiera umowę np. typu joint venture.

- **SPRZEDAŻ PRODUKTÓW:** Spółka prowadzi sprzedaż produktów z wykorzystaniem własnego zespołu, który jest w bezpośrednim kontakcie z szeregiem odbiorców zainteresowanych produktami i rozwiązaniami Spółki w obrębie linii biznesowych: urządzeń DPS, modułów UPD, systemów ODRA oraz HPM (nanotusze). Spółka posiada również własne centrum demonstracyjno-sprzedażowe w Bostonie oraz centrum demonstracji na Tajwanie prowadzone wspólnie z firmą Manz Asia.

- **MIĘDZYNARODOWA SIEĆ DYSTRYBUTORÓW:** Począwszy od 2021 roku Spółka rozpoczęła budowę sieci dystrybutorskiej, która ułatwi promowanie technologii i produktów XTPL na najważniejszych dla Emitenta rynkach.

Optimalny model biznesowy jest wybierany przez Spółkę w zależności od specyfiki klientów w danym polu aplikacyjnym. Obecnie prowadzone rozmowy uwzględniają wszystkie wymienione powyżej modele biznesowe, a wybór właściwego dokonywany jest w trakcie budowania relacji.

5.9 Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy Raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Emitenta

5.9.1 Postępy i osiągnięcia Emitenta w komercjalizacji technologii oraz produktów

W I połowie 2026 Spółka koncentrowała się na umacnianiu pozycji dostawcy precyzyjnej technologii addytywnej w branżach wyświetlaczy, półprzewodników, płytek drukowanych i elektroniki elastycznej. W efekcie tych działań osiągnęła istotne postępy w komercjalizacji technologii i produktów.

Strategiczne partnerstwo z firmą Manz Asia

W lutym 2026 roku Spółka zawarła umowę o strategicznym partnerstwie z firmą Manz Asia. Manz Asia to wyspecjalizowany producent zaawansowanych maszyn dla przemysłu półprzewodnikowego, zatrudniający ok. 380 inżynierów i specjalistów, z ponad 40-letnim doświadczeniem w automatyzacji procesów produkcyjnych dla branży półprzewodnikowej i wyświetlaczy. Firma specjalizuje się w panel-level packaging, w tym

w technologiach Fan-Out Panel-Level Packaging [“FOPLP”], Through Glass Via [“TGV”] oraz IC substrates. Posiada struktury operacyjne na Tajwanie (Taoyuan), w Chinach (Suzhou) i w Indiach (New Delhi) oraz dedykowane Semiconductor Innovation R&D Center w Taoyuan.

W ramach umowy firma Manz Asia zakupiła od XTPL Delta Printing System, który został zainstalowany w Centrum Badań i Rozwoju Innowacji Półprzewodnikowych firmy Manz w Taoyuan na Tajwanie. W centrum tym firmy XTPL i Manz Asia mają możliwość wspólnie przeprowadzać prezentacje i oceny technologii ultraprecyzyjnego dozowania dla klientów przemysłowych z sektora zaawansowanego mikromontażu półprzewodników. Obaj partnerzy wnoszą do współpracy własne bazy klientów zainteresowanych technologią precyzyjnego drukowania.

W perspektywie długoterminowej partnerstwo obejmuje możliwość integracji technologii UPD z maszynami Manz Asia w ramach dedykowanych projektów wdrożeniowych w zakładach klientów. Jednocześnie Manz Asia objął rolę dystrybutora produktów i usług XTPL na Tajwanie i w Indiach, gdzie działa od prawie 20 lat i dysponuje wyspecjalizowanym zespołem sprzedaży i wsparcia technicznego.

Tajwan jest jednym z kluczowych światowych rynków technologii półprzewodnikowej i jednym ze strategicznych rynków XTPL. Spółka prowadzi obecnie zaawansowany projekt ewaluacyjny we współpracy z wiodącym tajwańskim producentem półprzewodników. Partnerstwo z Manz Asia znacznie skraca dystans do decydentów i innowatorów w lokalnym ekosystemie przemysłowym. Wspólne centrum demonstracyjne w Taoyuan umożliwia ocenę technologii XTPL w pobliżu potencjalnych klientów, co stanowi kluczowy czynnik w procesach zaopatrzeniowych głównych graczy przemysłowych w regionie. Dla XTPL partnerstwo z uznanym lokalnym podmiotem stanowi optymalny model wejścia na rynki azjatyckie, który uzupełnia model spółki zależnej będącej w całości własnością firmy, z powodzeniem wdrożony w Stanach Zjednoczonych (XTPL Inc., Boston), oraz umożliwia szybszą penetrację rynku przy znacznie niższych nakładach kapitałowych.

Pierwsza sprzedaż systemu ODRA

W marcu 2026 roku Spółka przyjęła pierwsze zamówienie na system ODRA. Urządzenie ODRA (wcześniej znane pod roboczą nazwą DPS+) stanowi czwartą linię biznesową XTPL, wypełniając lukę między urządzeniami laboratoryjnymi DPS a modułami przemysłowymi UPD. Ten samodzielny system jest przeznaczony do produkcji przemysłowej typu High-Mix, Low-Volume (HMLV), czyli zróżnicowanej produkcji w małych partiach. Kluczowe cechy ODRA to: potencjał powtarzalnych zamówień, klienci przemysłowi, kontrahenci z sektora obronnego oraz cena jednostkowa wynosząca 400 000–500 000 dolarów.

Pierwszym nabywcą systemu ODRA jest klient przemysłowy z siedzibą w Dolinie Krzemowej (Kalifornia, USA), specjalizujący się w zaawansowanym mikromontażu półprzewodników oraz świadczący usługi w zakresie prototypowania i produkcji małoseryjnej (HMLV) dla wymagających klientów z sektorów technologicznego i obronnego. Klient posiada certyfikat ITAR (International Traffic in Arms Regulations), co umożliwia mu współpracę z wykonawcami z sektora obronnego. Jest on również członkiem prestiżowego międzynarodowego konsorcjum badawczo-rozwojowego zajmującego się zaawansowanym mikromontażem półprzewodników w Dolinie Krzemowej. Klient ten nabył wcześniej system Delta Printing System i korzysta z niego od ponad roku w celu przeprowadzenia wstępnej oceny technologii XTPL. Zakup systemu ODRA stanowi ważne potwierdzenie skuteczności tej technologii. Klient przeszedł od urządzenia prototypowego do bardziej zaawansowanego narzędzia zorientowanego na produkcję, aby rozszerzyć własną ofertę usług. Istnieje potencjał, że po pomyślnej instalacji i walidacji pierwszego systemu klient zakupi dodatkowe jednostki ODRA.

Profil pierwszego przyszłego użytkownika ODRA, jego portfolio klientów oraz certyfikat ITAR stwarzają znaczny potencjał dla technologii XTPL w projektach realizowanych dla sektora obronnego. Spółka już wcześniej sygnalizowała zainteresowanie podmiotów z sektora obronnego technologią UPD, co zaowocowało sprzedażą systemu DPS amerykańskiemu klientowi przemysłowemu z sektora obronnego. Kolejny egzemplarz systemu

DPS został sprzedany Uniwersytetowi Massachusetts w Lowell, który prowadzi Instytut Badawczy Raytheon-UMass Lowell (RURI). Potencjalne zastosowania obejmują ekranowanie elektromagnetyczne dronów, komunikację wysokoczęstotliwościową dla radarów oraz naprawę zaawansowanych komponentów mikroelektronicznych w pobliżu pola walki.

Pierwsza sprzedaż modułu UPD do klienta przemysłowego w Japonii

W czerwcu Spółka potwierdziła zamówienie na moduł UPD od notowanego na giełdzie japońskiego podmiotu z blisko czterdziestoletnim doświadczeniem w projektowaniu i dostarczaniu zaawansowanych, zautomatyzowanych urządzeń przemysłowych dla globalnego sektora elektroniki i półprzewodników. Moduł UPD zostanie zintegrowany z prototypową maszyną przemysłową budowaną przez Klienta i wykorzystany w procesach yield management (poprawy uzysków produkcyjnych) dla zaawansowanych obwodów drukowanych HDI/UHDI PCB oraz podłoży dla półprzewodników związanych z obszarem zaawansowanego pakowania (advanced packaging). Była to pierwsza sprzedaż urządzenia XTPL do Japonii. Zamówienie było efektem przeprowadzonej ewaluacji technologicznej oraz około rocznego rozwoju relacji pomiędzy stronami. Projekt wszedł w najbardziej zaawansowaną fazę procesu wdrożeniowego - czwarty etap, tj. budowę prototypowej maszyny przemysłowej zintegrowanej z modułem UPD, poprzedzający decyzję o wdrożeniu przemysłowym (etap piąty). Tym samym zamówienie powiększyło najbardziej zaawansowaną część przemysłowego pipeline'u XTPL oraz poszerzyło go o nową geografie. Kluczowym czynnikiem decyzji Klienta jest unikalna zdolność XTPL do wysokoprecyzyjnego dozowania ścieżek miedzianych (copper traces) materiału istotnie trudniejszego w precyzyjnym dozowaniu niż srebro dominujące w aplikacjach dla nowoczesnych wyświetlaczy (ang. flat panel display FPD). Zamówiony moduł wyróżnia się bardziej zaawansowaną specyfikacją i konstrukcją niż moduły wykorzystywane w aplikacjach FPD, co przekłada się na ok. dwukrotnie wyższą jednostkową wartość sprzedaży. Sprzedaż jest wspierana przez lokalnego dystrybutora XTPL w Japonii - firmę PEC (Printed Electronics Corporation).

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System wraz z dedykowanym systemem laserowym do nowego partnera przemysłowego w Japonii

Po dacie bilansowej nastąpiło potwierdzenie kolejnego zamówienia z rynku japońskiego. Przedmiotem zamówienia jest system DPS wraz z dedykowanym systemem laserowym umożliwiającym spiekanie laserowe wydrukowanych ścieżek miedzianych.

Zamawiającym jest japoński producent zaawansowanych, zautomatyzowanych maszyn przemysłowych dla globalnego sektora elektroniki i technologii półprzewodnikowych, posiadający kilkudziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu i dostarczaniu takich rozwiązań na wielu rynkach na świecie.

Urządzenie DPS pełni funkcję laboratoryjnego demonstratora technologii Ultra-Precise Dispensing oraz narzędzia do jej samodzielnej walidacji przez Klienta. Wraz z dedykowanym systemem laserowym zostanie wykorzystane w procesach yield management (poprawy uzysków produkcyjnych) dla zaawansowanych struktur stosowanych w obszarze zaawansowanego pakowania (advanced packaging) w tym zaawansowanych obwodów drukowanych HDI/UHDI PCB oraz podłoży dla półprzewodników z użyciem miedzi jako materiału przewodzącego. Zamówienie jest konsekwencją pomyślnej walidacji technologii przeprowadzonej wspólnie przez Klienta i XTPL w laboratorium Spółki we Wrocławiu i wiąże się z przejściem projektu do trzeciego z pięciu etapów procesu wdrożeń przemysłowych XTPL, w ramach którego Klient rozpoczyna samodzielną walidację technologii Spółki we własnym laboratorium badawczo-rozwojowym. W przypadku pozytywnych wyników kolejny etap obejmuje zamówienie modułu UPD oraz jego integrację w prototypowej maszynie przemysłowej

Klienta (etap czwarty), poprzedzającą decyzję o pełnym wdrożeniu przemysłowym technologii XTPL (etap piąty).

Sprzedaż jest wspierana przez lokalnego dystrybutora XTPL w Japonii, firmę PEC (Printed Electronics Corporation).

Zamówienie ramowe na 10 modułów UPD w obszarze technologii nowoczesnych wyświetlaczy (FPD) w ramach kontynuacji pierwszego wdrożenia przemysłowego technologii XTPL w Chinach

Również po dacie bilansowej wpłynęło do Spółki zamówienie ramowe na 10 modułów UPD w obszarze technologii nowoczesnych wyświetlaczy (FPD), które zostaną wykorzystane do budowy kolejnych maszyn przemysłowych pracujących na linii produkcyjnej klienta końcowego - jednego z największych producentów wyświetlaczy FPD (Flat Panel Display) w Chinach. Moduły UPD zostaną wykorzystane w procesach yield management (poprawy uzysków produkcyjnych) w nowoczesnych wyświetlaczach FPD (ang. Flat Panel Display) o ultrawysokiej rozdzielczości.

Zamówienie stanowi kolejny etap pierwszego w historii Emitenta wdrożenia przemysłowego technologii UPD, zapoczątkowanego w styczniu 2025 roku, w ramach którego Spółka zrealizowała zamówienie na pierwszą partię 6 modułów UPD, dostarczonych Klientowi Końcowemu i pomyślnie zintegrowanych z przemysłowymi urządzeniami do procesów yield management. Obecne zamówienie potwierdza kontynuację tej współpracy w ramach wieloletniego projektu wdrożeniowego.

Osiągnięcia i postępy w pracach badawczo-rozwojowych

Główne osiągnięcia i postępy w pracach badawczo-rozwojowych w Okresie Sprawozdawczym dotyczyły:

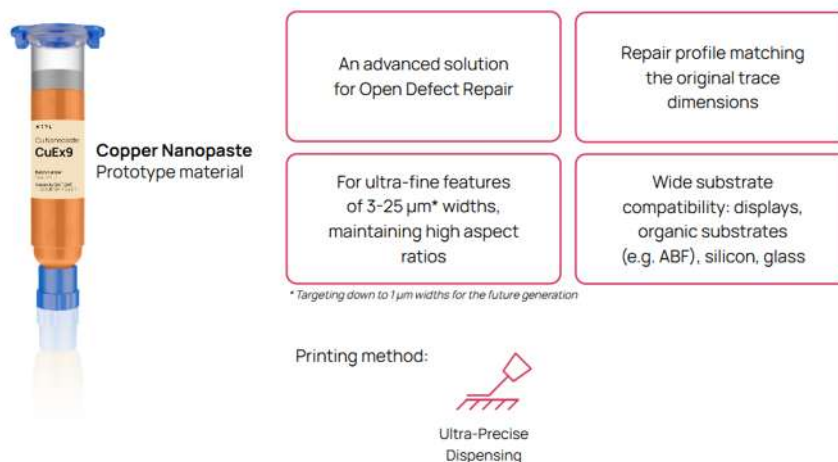
1. Rozwoju tuszów o wysokim stężeniu (past) na bazie nanocząstek miedzi dedykowanych do naprawy defektów w zaawansowanych płytkach PCB: HDI (High Density Interconnect) oraz Ultra HDI (UHDI).
2. Rozwoju tuszów o wysokim stężeniu (past) na bazie nanocząstek złota do zastosowań związanych z sektorem MedTech (technologie medyczne) i Biotech (biotechnologia).
3. Opracowania możliwości wykorzystania technologii Ultra-Precise Dispensing (UPD) do wypełniania przelotek TSV z użyciem past srebrnych rozwijanych w XTPL, osiągając struktury o bardzo wysokim współczynniku głębokości przelotki do jej średnicy dochodzącym do 14:1.
4. Opracowania technologii wydłużenia czasu życia dla dysz o zewnętrznej średnicy otworu 1.5 um do co najmniej 5 dni pracy w warunkach przemysłowych.
5. Opracowanie techniki drukowania mikroelektrod do charakteryzacji elektrycznej materiałów 2D.
6. Opracowania, budowy oraz dostarczenia do klienta modułu drukującego UPD w wersji PRO.
7. Prace nad realizacją projektów w ramach procesu NPD (New Product Development) odpowiadających roadmapie rozwoju urządzeń DPS, modułów UPD oraz materiałów HPM.

W raportowanym okresie Zespół B+R pracował nad opracowaniem pasty bazującej na nanocząstkach miedzi, o wysokiej zawartości materiału stałego i kompatybilnej z technologią UPD. Opracowywana pasta jest dedykowana do naprawy defektów w zaawansowanych płytkach PCB: HDI (High Density Interconnect) oraz Ultra HDI (UHDI). Pasta bazująca na nanocząstkach Cu umożliwia:

- naprawę otwartych defektów w ścieżkach przewodzących,
- precyzyjne odtworzenie profilu naprawy zgodnie z wymiarami oryginalnej ścieżki,
- drukowanie bardzo wąskich struktur o szerokości 3–25 µm przy zachowaniu wysokiego współczynnika kształtu,

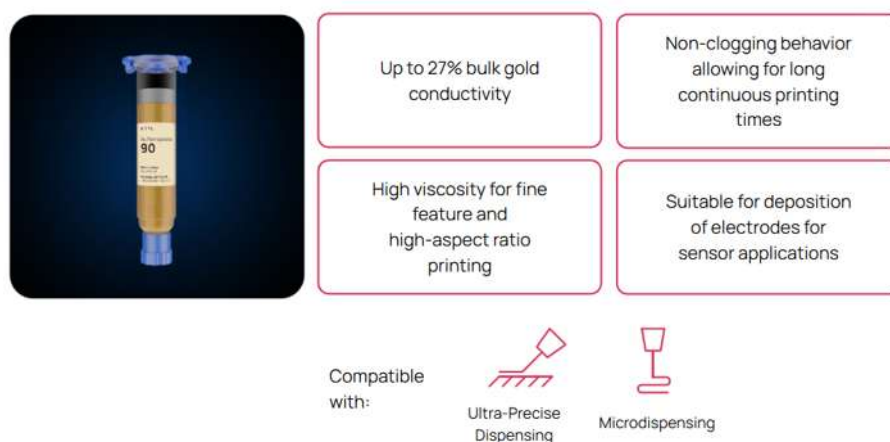
- pracę na różnych typach podłoży, takich jak szkło, krzem, podłoża organiczne, w tym ABF, oraz elementy wyświetlaczy,
- nanoszenie materiału metodą Ultra-Precise Dispensing.

Prace nad udoskonaleniem pasty bazującej na nanocząstkach Cu będą kontynuowane również w kolejnym okresie sprawozdawczym.



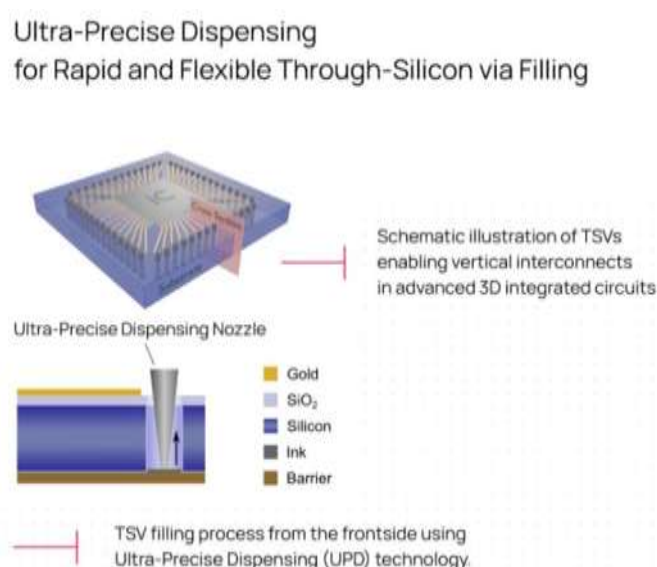
Rys. Podsumowanie produktu Au90 przeznaczonego do druku w technologii UPD oraz komercyjnie dostępnych dyspenserach.

W raportowanym okresie Zespół B+R pracował również nad ulepszeniem formuły opartej na nanocząstkach złota o procentowej zawartości metalu powyżej 90%. Jest on przeznaczony do wykorzystania w precyzyjnej elektronice drukowanej, szczególnie w precyzyjnym drukowaniu i osadzaniu elektrod w sensorach do zastosowań związanych z sektorem MedTech (technologie medyczne) i Biotech (biotechnologia). Pasta Au 90 zapewnia precyzyjne drukowanie mikrostruktur o złożonej geometrii w oparciu o drukarkę DPS, a dzięki wysokiemu poziomowi zawartości złota umożliwia efektywną depozycję dużej ilości materiału przewodzącego w jednej iteracji. Dzięki wyjątkowym właściwościom przeciwdziałającym zatykaniu mikrodysz, jest idealnym produktem do nanoszenia drobnych detali na różnych podłożach, takich jak szkło, płytki PCB oraz folie (np. PET, Kapton). W okresie sprawozdawczym opracowano technikę druku ścieżek przewodzących o szerokości 1.5 - 3 μm i odległości między nimi w zakresie do 0.6 μm, co obecnie jest nieosiągalne żadną inną techniką druku.



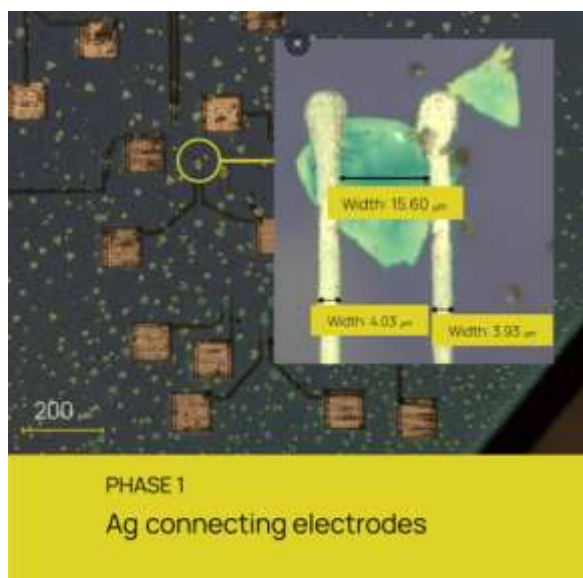
Rys. Podsumowanie produktu Au90 przeznaczonego do druku w technologii UPD oraz komercyjnie dostępnych dyspenserach.

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace badawczo-rozwojowe umożliwiające wykazanie możliwości zastosowania technologii Ultra-Precise Dispensing (UPD) do wypełniania przelotek Through-Silicon Via (TSV) z użyciem past srebrnych rozwijanych w XTPL, osiągając struktury o bardzo wysokim współczynniku głębokości przelotki do jej średnicy dochodzącym do 14:1. Uzyskano jednorodne wypełnienie przelotek oraz przewodzące połączenia elektryczne o rezystancji na poziomie $2.94\text{--}5.53\ \Omega\ \text{TSV}^{-1}$ dla przelotek wykonywanych w podłożu krzemowym o grubości 280 μm . Badania obejmowały również przygotowanie kolejnych etapów walidacji technologii, które są kluczowe dla zastosowań w zaawansowanej mikroelektronice. Równolegle prowadzono działania ukierunkowane na zwiększenie skalowalności procesu i przepustowości produkcyjnej. Całość prac potwierdziła potencjał technologii UPD jako nowej generacji podejścia do wytwarzania TSV przy uproszczonym procesie technologicznym i ograniczonej liczbie etapów post-processingu.



Rys. Schemat procesu wypełniania przelotek Through-Silicon Via (TSV) z wykorzystaniem technologii Ultra-Precise Dispensing (UPD) oraz przykładowe zastosowanie TSV w zaawansowanych układach 3D integrated circuits.

Prace rozwojowe prowadzono również w obszarze bezpośredniego drukowania mikroelektrod do charakteryzacji elektrycznej materiałów 2D, takich jak grafen, MoS_2 oraz NbS_2 . W ramach projektu technologię XTPL Ultra-Precise Dispensing wykorzystano do nanoszenia przewodzących elektrod bezpośrednio na płatkę NbS_2 osadzone na podłożu SiO_2/Si . Uzyskano struktury o szerokości nawet 1 μm , potwierdzając możliwość szybkiego, elastycznego i bezmaskowego wykonywania kontaktów elektrycznych bez konieczności stosowania złożonych procesów litograficznych.

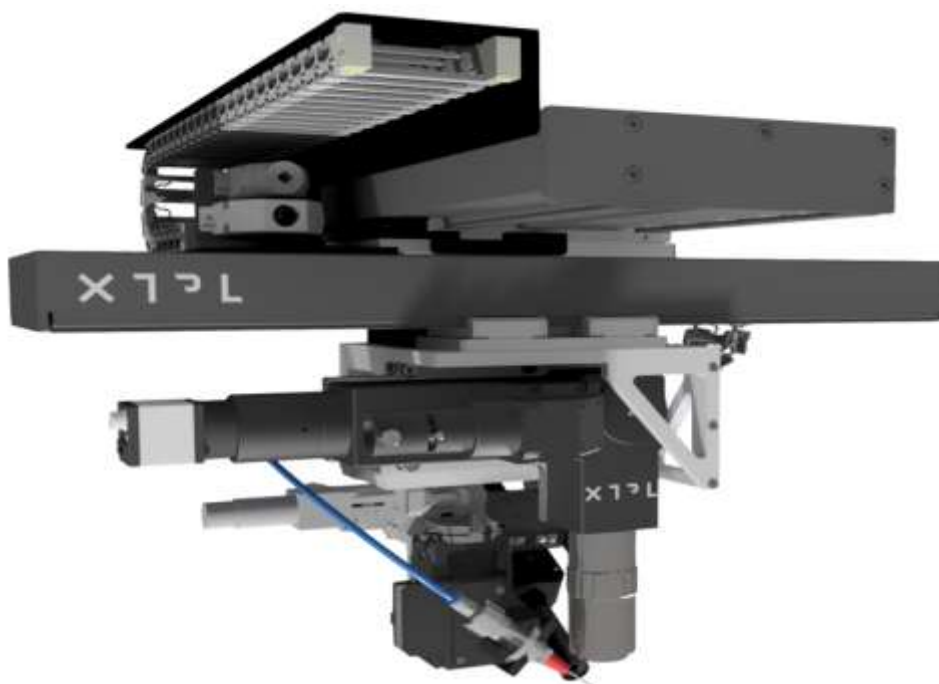


W okresie sprawozdawczym realizowane prace związane z opracowaniem technologii wydłużenia czasu życia dla dysz o zewnętrznej średnicy otworu 1.5 μm do co najmniej 5 dni pracy w warunkach przemysłowych. Opracowany prototyp rozwiązania jest testowany u klienta przemysłowego w aplikacji naprawy defektów w wyświetlaczach microOLED.

W okresie sprawozdawczym ukończono prace badawczo-rozwojowe oraz budowę pierwszego modułu drukującego UPD w wersji PRO do integracji przemysłowej w ramach prowadzonej ewaluacji technologii z klientem z USA (jeden z czterech największych na świecie producentów dużych maszyn przemysłowych dla producentów elektroniki nowej generacji wchodzący w skład indeksu NASDAQ 100, dostarczający globanie swoje rozwiązania do wiodących producentów półprzewodników oraz

wyświetlaczy FPD). Moduł UPD PRO posiada rozszerzoną konfigurację i został zaprojektowany do specjalistycznych zastosowań oczekiwanych przez amerykańskiego klienta, na podstawie prowadzonych przez niego badań rynkowych. Moduł UPD PRO charakteryzuje się następującymi przymiotami:

- kompletny system, wyposażony w głowicę drukującą oraz podsystemy sterowania, przeznaczony do integracji w maszynach przemysłowych,
- główny zakres roboczy 300 x 300 mm z wysoką precyzją pozycjonowania dyszy, rozszerzony o dodatkowe silniki kalibracyjne,
- zaawansowane systemy optyczne do obrazowania procesu druku,
- wbudowany mikroskop z dostosowaniem właściwości do określonych zastosowań,
- przemysłowe interfejsy i protokoły komunikacji, dedykowane oprogramowanie.



W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace nad opracowaniem i budową kolejnych modułów UPD PRO, które będą częścią systemu ODRA budowanego dla klienta przemysłowego z siedzibą w Dolinie Krzemowej w USA, który specjalizuje się w zaawansowanym pakowaniu półprzewodników, świadcząc usługi dla klientów z sektora technologicznego i obronnego, w tym wiodących spółek z indeksów S&P500 i Nasdaq 100 oraz globalnych grup zbrojeniowych.

W pierwszym półroczu 2026 roku opublikowano lub przyjęto do publikacji trzy prace naukowe wykorzystujące technologię XTPL Ultra-Precise Dispensing:

1. *Bio-integrated μ Bots with overtone ultrawideband magnetoelectric antennas for wireless telemetry* – w pracy opublikowanej w Science Advances pasta srebrna XTPL CL85 została wykorzystana do wykonania bezpośrednich połączeń pomiędzy antenami a ceramiczną płytką PCB, jako alternatywa dla klasycznego wire bondingu w implantowalnych urządzeniach telemetrycznych.
2. *Periodically Loaded Coplanar Waveguide-based Filters Fabricated via Ultra-Precise Deposition for Neurological Interfaces* – technologię UPD zastosowano do drukowania srebrnych filtrów RF oraz warstwy enkapsulującej na elastyczno-sztywnej płytce PCB przeznaczonej do implantowalnych interfejsów neurologicznych. Uzyskano linie o szerokości około 70 μ m oraz odporność na ponad 500 cykli zginania.
3. *Metal-Insulator-Metal Ag/SnO₂/Al₂O₃/Ag Diodes Fabricated by Ultraprecise Dispensing and Atomic Layer Deposition* – zaprezentowano diody tunelowe MIM wykonane z drukowanych elektrod srebrnych oraz warstw izolacyjnych wytwarzanych metodą ALD. Struktury wykazały niską rezystancję przy zerowym napięciu i wysoką responsywność, istotną dla zastosowań w układach rectenna.

Kamienie milowe osiągnięte przez Emitenta w I półroczu 2026 roku

1. Uzyskanie wydruków złotych ścieżek przewodzących o szerokości 1.5–3 μ m oraz odległości między ścieżkami do 0.6 μ m, co obecnie pozostaje nieosiągalne dla innych konwencjonalnych technik druku.
2. Wykonanie demonstratorów technologii potwierdzających możliwość zastosowania technologii Ultra-Precise Dispensing (UPD) do wypełniania przelotek Through-Silicon Via (TSV) z wykorzystaniem past srebrnych rozwijanych w XTPL, osiągając struktury o bardzo wysokim współczynniku aspektu dochodzącym do 14:1.
3. Budowa oraz dostarczenie do klienta pierwszego modułu drukującego UPD w wersji PRO, przeznaczonego do zaawansowanych aplikacji mikroelektronicznych wymagających ultra-precyzyjnego dozowania materiałów funkcjonalnych.
4. Uzyskanie rekomendacji do dofinansowania w konkursie FENG.05.01-IP.01-004/25, Ścieżka B: Technologie cyfrowe i innowacje w ramach głębokich technologii, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), projektu pt. "Opracowanie addytywnej technologii integracji fotonicznych układów scalonych dla zastosowań w sztucznej inteligencji".
5. Wykonanie demonstratorów technologii potwierdzających możliwość zastosowania technologii Ultra-Precise Dispensing (UPD) do naprawy defektów w zaawansowanych obwodach drukowanych HDI/UHDI PCB.

5.9.2 Emisja papierów wartościowych

W I półroczu 2026 roku Spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania finansowania Spółki opartego na pozyskaniu środków finansowych z emisji nowych akcji (komunikat ESPI nr 3/2026 z dnia 9 lutego 2026 roku).

Spółka wyemitowała 300.000 akcji serii Y o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) („Akcje Serii Y”). Akcje Serii Y zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 03/03/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 marca 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii Y z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym (raport bieżący ESPI nr 20/2026 z dnia 10 kwietnia 2026 roku). Subskrypcja Akcji Serii Y została zakończona w dniu 24 marca 2026 roku, w jej ramach objętych zostało 300.000 Akcji Serii Y, a Zarząd Spółki złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki, w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 294.987,70 zł i dzieli się na 2.949.877 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł. Zmiany statutu Spółki w tym zakresie zostały zarejestrowane w KRS w dniu 30 marca 2026 roku (raport bieżący ESPI nr 18/2026 z dnia 30 marca 2026 roku).

Akcje Serii Y zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym z dniem 13 kwietnia 2026 roku (raport bieżący ESPI nr 21/2026 z dnia 13 kwietnia 2026 roku).

W Okresie Sprawozdawczym Spółka nie wyemitowała obligacji.

W II półroczu spółka wydała komunikat o zamiarze pozyskania finansowania poprzez emisję akcji serii Z oraz ustanowienie kapitału docelowego (komunikat ESPI nr 34/2026 z dnia 1 września 2026 roku oraz 36/2026 z dnia 18 września 2026 roku).

Zarząd proponuje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie mniej niż 198.462 i nie więcej niż 400.000 Akcji Serii Z, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej 65,00 zł za jedną Akcję Serii Z. Emisja Akcji Serii Z ma zostać przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, realizowanej w drodze oferty publicznej, w odniesieniu do której zastosowanie znajdują wyjątki od obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2017/1129.

Intencją Zarządu jest, aby emisja Akcji Serii Z została przeprowadzona w taki sposób, aby akcjonariusze Spółki posiadający co najmniej 0,5% ogólnej liczby akcji Spółki [każdy indywidualnie] według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Nowym NWZ ["Inwestorzy Uprawnieni"] mieli możliwość skorzystania z pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii Z w liczbie umożliwiającej danemu Inwestorowi Uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki niż udział, jaki ten Inwestor Uprawniony posiadał na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Nowym NWZ. Powyższe będzie miało zastosowanie pod warunkiem, że Inwestorzy Uprawnieni złożą deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii Z, a następnie przyjmą skierowane do nich oferty objęcia Akcji Serii Z. Złożenie oferty objęcia Akcji Serii Z będzie należało do wyłącznego uznania Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki doloży należytej staranności, aby zaoferować Akcje Serii Z tym Inwestorom Uprawnionym, którzy spełnią określone powyżej warunki, jeżeli rozliczenie subskrypcji Akcji Serii Z na rzecz danego Inwestora Uprawnionego będzie mogło zostać od strony technicznej dokonane w terminie określonym przez Zarząd Spółki ["Mechanizm Pierwszeństwa"].

5.9.3 Dofinansowanie

W kwietniu 2026 roku Spółka podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR") umowę o dofinansowanie w konkursie FENG.05.01-IP.01-004/25, Ścieżka B: Technologie cyfrowe i innowacje w ramach głębokich technologii, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (komunikat ESPI nr 22/2026 z dnia 17 kwietnia 2026 roku). Dofinansowanie dotyczy projektu opracowanego przez Spółkę pt.

"Opracowanie addytywnej technologii integracji fonicznych układów scalonych dla zastosowań w sztucznej inteligencji". Głównym założeniem Projektu jest opracowanie, budowa i walidacja prototypu nowej generacji systemu drukującego, przeznaczonego do heterogenicznej integracji fonicznych i elektronicznych układów scalonych (PIC + EIC) w ramach procesów zaawansowanego pakowania (Advanced Packaging). Opracowana technologia stanowić będzie element europejskiego łańcucha wartości w obszarze zaawansowanych półprzewodników.

Całkowita wartość projektu wynosi 18 286 399,84 zł, w tym rekomendowana kwota dofinansowania 10 091 591,16 zł. Okres realizacji projektu 01.05.2026 - 31.12.2029.

5.9.4 Działania podejmowane przez Emitenta w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

W procesie komercjalizacji technologii opracowywanych przez Spółkę, istotną rolę odgrywa własność intelektualna (IP), która stanowi przewagę konkurencyjną XTPL. Rozwój portfolio IP i jego odpowiednia ochrona są kluczowe dla pozycji rynkowej firmy i znacząco wpływają na jej wartość. Rozwiązania technologiczne XTPL są chronione od momentu zgłoszenia patentowego.

Spółka wyróżnia 5 grup patentowych dla swojej technologii oraz opartej o nią produktów:

1. Proces UPD - patenty opisujące proces ultraprecyzyjnej depozycji lub urządzenia wykorzystywane do tego procesu;
2. Nanotusze - patenty zabezpieczające różne formułacje nanotuszków;
3. Oprogramowanie - patenty zabezpieczające rozwiązania zaimplementowane w oprogramowaniu sterującym urządzeniami drukującymi;
4. Pola aplikacyjne - patenty opisujące rozwiązania konkretnych problemów technologicznych z wykorzystaniem metody UPD;
5. Charakteryzacja i kontrola jakości - patenty związane z charakteryzacją i kontrolą jakości wybranych elementów urządzeń drukujących

W I półroczu 2026 roku Spółka kontynuowała działania związane z rozwojem chmury patentowej, tj.

1. W dniu 4 lutego 2026 r. Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) zastrzeżeń patentowych dla wynalazku pt. „Metallic nanoparticle composition and method of dispensing metallic nanoparticle composition”,
2. W dniu 12 lutego 2026 r. Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Chiński Urząd Własności Intelektualnej (CNIPA) zastrzeżeń patentowych dla wynalazku pt. „Methods for forming features by dispensing metal nanoparticle compositions from inkjet printheads and metal nanoparticle compositions for inkjet printing”.

Ponadto po Okresie Sprawozdawczym Spółka uzyskała następującą ochronę w zakresie własności przemysłowej i intelektualnej:

1. W dniu 7 lipca 2026 r. Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) zastrzeżeń patentowych dla wynalazku pt. „A method for additive manufacturing and an additive manufacturing apparatus”.

W procesie zgłaszania wniosków patentowych Spółka stosuje się do zaleceń współpracujących z nią kancelarii patentowych. Zalecenia pomagają tworzyć wnioski patentowe jak najwyższej jakości i w rezultacie wzmocnić poziom ochrony własności intelektualnej Spółki.

Na Datę Raportu Spółka posiada łącznie 48 przyznanych patentów, obowiązujących na terenie m.in. Japonii, Chin, Korei Południowej, Malezji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na Datę Raportu Spółka posiadała zarejestrowane znaki towarowe w Urzędzie Patentowym RP, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej, a także w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Budowa chmury patentowej dla rozwijanej technologii oraz produktów jest istotnym elementem strategii Spółki, budującym wiarygodność Emitenta wobec potencjalnych klientów przemysłowych. Uzyskana w konsekwencji zgłoszeń ochrona patentowa wpłynie na podniesienie wartości potencjalnej komercjalizacji technologii Spółki w zakresie wdrożeń przemysłowych. Spółka planuje dalsze zgłoszenia patentowe wynalazków jakie będą powstawały w toku bieżących oraz przyszłych prac badawczo-rozwojowych.

5.9.5 Aktywność Emitenta w wydarzeniach dedykowanych inwestorom rynku kapitałowego

W celu realizacji standardów w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacji, zapewnienia stałego i równego dostępu do informacji o Spółce dla wszystkich interesariuszy oraz wychodząc naprzeciw ich potrzebom, Emitent podejmuje liczne działania w zakresie relacji inwestorskich.

Spółka dba o regularną komunikację z rynkiem kapitałowym m.in. poprzez stale aktualizowaną stronę internetową z wyodrębnionym serwisem relacji inwestorskich na której zamieszczane są materiały informacyjne (m.in. komunikaty prasowe, prezentacje inwestorskie) oraz wybrane publikacje medialne. Dodatkowo, Emitent stara się w możliwie najkrótszym czasie rzetelnie odpowiadać na pytania przesłane przez inwestorów indywidualnych. W celu ułatwienia kontaktu ze Spółką, w serwisie relacji inwestorskich w zakładce „Kontakt” wskazane zostały dane kontaktowe dla inwestorów instytucjonalnych i analityków, inwestorów indywidualnych oraz dla dziennikarzy. Konferencje wynikowe w języku polskim oraz angielskim Spółka zamieszcza na swoim kanale firmowym w serwisie youtube: <https://www.youtube.com/@xtpls/videos>.

W I półroczu 2026 Spółka odbyła szereg spotkań z inwestorami w związku z trwającym w dniach 10-12 marca 2026 roku procesem przyspieszonej budowy księgi popytu. Do wybranych inwestorów kwalifikowanych lub mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani, skierowana została oferta objęcia łącznie 300.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii Y. Proces przyspieszonej budowy księgi popytu zakończył się w dniu 12 marca, a w jego wyniku cena jednej akcji serii Y została ustalona na 65,00 zł. Duże zainteresowanie ze strony obecnych oraz nowych inwestorów, przełożyło się na niskie jednocyfrowe dyskonto na poziomie ok. 2% względem średniej ważonej wolumenem obrotu dla kursu z okresu 30 dni przed walnym zgromadzeniem uchwalającym emisję akcji.

W dniu 30 kwietnia 2026 roku Spółka zorganizowała dla inwestorów i wszystkich interesariuszy rynku kapitałowego dwie wideokonferencje wynikowe, podczas których Zarząd Spółki omówił wyniki finansowe Emitenta za IV kwartał 2025 roku oraz cały 2025 rok. Pierwsze spotkanie odbyło się w języku polskim, a drugie w języku angielskim. Podczas obu wideokonferencji Zarząd XTPL S.A. zaprezentował wyniki finansowe i operacyjne Spółki, podsumował najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia tego okresu oraz odpowiedział na pytania inwestorów w sekcji Q&A.

Link do konferencji (PL): <https://www.youtube.com/watch?v=i-4lqx3Vybc>

Link do konferencji (ENG): <https://www.youtube.com/watch?v=sUDWI5hDoro>

Emitent na bieżąco analizuje kolejne wydarzenia inwestorskie, w których będzie mógł aktywnie przedstawiać swoje osiągnięcia w zakresie technologii, jej komercjalizacji, wyników finansowych oraz perspektyw rozwoju.

Wydarzenia inwestorskie po Dniu Bilansowym

W dniu 2 lipca 2026 roku Spółka zorganizowała dla inwestorów i wszystkich interesariuszy rynku kapitałowego webinar edukacyjny poświęcony rozwijanej w XTPL technologii Ultra-Precise Dispensing (UPD). W spotkaniu udział wzięli Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A. oraz Piotr Kowalczewski, Dyrektor ds. Własności Intelektualnej XTPL S.A., a całość moderował Michał Mastowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII). Webinar został przeprowadzony na kanale SII.

Podczas webinaru inwestorzy dowiedzieli się m.in. jakie megatrendy napędzają rozwój zaawansowanej elektroniki, jak działa technologia Ultra-Precise Dispensing (UPD), czym UPD różni się od innych metod nanoszenia materiałów, jakie parametry wyróżniają technologię XTPL, jakie są przykładowe zastosowania UPD w półprzewodnikach, wyświetlaczach, zaawansowanym pakowaniu układów, naprawie defektów, optyce i ekranowaniu elektromagnetycznym.

Link do webinaru (PL): <https://www.sii.org.pl/19156/aktualnosci/czat-inwestorski/webinar-edukacyjny-xtpl-technologie-ultra-precise-dispensing-upd-i-jej-zastosowania.html>

Emitent na bieżąco analizuje kolejne wydarzenia inwestorskie, w których będzie mógł aktywnie przedstawiać swoje osiągnięcia w zakresie technologii, jej komercjalizacji, wyników finansowych oraz perspektyw rozwoju.

5.9.6 Aktywność Emitenta w wydarzeniach branżowych

38th NEPCON Japan (Tokio, Japonia, styczeń 2026) XTPL uczestniczyło w targach NEPCON Japan wraz z lokalnym dystrybutorem, prezentując technologię Ultra-Precise Dispensing oraz prowadząc działania wspierające rozwój relacji biznesowych na rynku azjatyckim.

Politechnika Łódzka, Department of Semiconductor and Optoelectronic Devices (Łódź, Polska, styczeń 2026) Przedstawiciele XTPL odwiedzili Katedrę Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej, jednostkę prowadzącą badania w obszarze mikroelektroniki i optoelektroniki.

ICONN 2026 (Sydney, Australia, luty 2026) Spółka była obecna podczas konferencji ICONN 2026 za pośrednictwem dystrybutora, promując rozwiązania XTPL dla zaawansowanej mikroelektroniki i aplikacji deep-tech.

ECS Brokerage Event (Bruksela, Belgia, luty 2026) Przedstawiciel XTPL uczestniczył w ECS Brokerage Event, spotkaniu europejskiego środowiska komponentów i systemów elektronicznych, które służy budowaniu konsorcjów przed konkursami Chips JU. Spółka przedstawiła prezentację oraz prowadziła rozmowy o współpracy przy europejskich projektach badawczo-rozwojowych.

innoLAE 2026 (Cambridge, Wielka Brytania, luty 2026) XTPL uczestniczyło w wydarzeniu innoLAE 2026 wraz z partnerem dystrybucyjnym. Podczas konferencji Business Development Manager XTPL wygłosił prezentację pt. „Ultra-Precise Dispensing: A Direct-Write Solution for Advanced Semiconductor Interconnects”, dotyczącą zastosowań technologii XTPL w obszarze zaawansowanych połączeń półprzewodnikowych.

LOPEC 2026 (Monachium, Niemcy, luty 2026) XTPL uczestniczyło w targach LOPEC 2026, prezentując rozwiązania z zakresu ultra-precyzyjnego druku dla rynku elektroniki drukowanej, addytywnej i elastycznej.

iMAPS Device Packaging (Phoenix, AZ, USA, marzec 2026) Przedstawiciel XTPL uczestniczył w 22. konferencji IMAPS Device Packaging, poświęconej zaawansowanemu packagingowi półprzewodników oraz technologiom montażu i połączeń układów.

EPIC Technology Meeting on Photonics for Defense: Securing the Future at Exosens (Brive, Francja, Marzec 2026) Przedstawiciel XTPL uczestniczył w zamkniętym spotkaniu technologicznym EPIC (European Photonics Industry Consortium) poświęconym fotonice dla sektora obronnego, zorganizowanym w siedzibie firmy Exosens. Spółka rozmawiała z dostawcami i integratorami technologii fonicznych o zastosowaniach technologii XTPL w elektronice dla sektora obronnego.

APEX 2026 (Anaheim, USA, marzec 2026) Spółka była obecna podczas targów IPC APEX EXPO 2026 wraz z partnerem dystrybucyjnym. XTPL reprezentował na miejscu Managing Director regionu Ameryki Północnej, prowadząc działania związane z rozwojem biznesu i prezentacją technologii Spółki.

SEMICON China 2026 (Szanghaj, Chiny, marzec 2026) XTPL uczestniczyło w targach SEMICON China 2026 wraz z lokalnym dystrybutorem, prezentując technologię Ultra-Precise Dispensing dla zastosowań w zaawansowanej mikroelektronice i półprzewodnikach.

INFRACHIP Industry hands-on AFM training (Cork, Tyndall, Irlandia, marzec-kwiecień 2026) Przedstawiciele XTPL wzięli udział w praktycznym szkoleniu z mikroskopii sił atomowych (AFM), zorganizowanym w Tyndall National Institute w ramach europejskiego projektu INFRACHIP, który wspiera rozwój kompetencji i infrastruktury w technologiach półprzewodnikowych.

ICDT (Chongqing, Chiny, marzec-kwiecień 2026) Przedstawiciel XTPL uczestniczył w konferencji ICDT 2026 (International Conference on Display Technology), organizowanej przez SID China i obejmującej cały łańcuch technologii wyświetlaczy. Spółka przedstawiła prezentację pt. „Ultra-Precise Dispensing for Advanced Display Manufacturing: From Pixel Repair to Wrap-Edge Interconnects”.

Rapid + TCT (Boston, USA, kwiecień 2026) XTPL uczestniczyło w targach RAPID + TCT 2026, jednym z głównych wydarzeń w Ameryce Północnej poświęconych wytwarzaniu przyrostowemu i przemysłowemu drukowi 3D.

Wydarzenie organizowane przez Georgia Tech (USA, maj 2026)

Przedstawiciele XTPL Inc., Urs Berger oraz Kyle Homan, biorą udział w zamkniętym wydarzeniu organizowanym przez Georgia Tech, poświęconym technologiom dla zaawansowanej mikroelektroniki i półprzewodników.

Chemnitz Seminar "Electronic Packaging and Applications" (Chemnitz, Niemcy, maj 2026) Przedstawiciel XTPL uczestniczył w seminarium organizowanym przez Fraunhofer ENAS wspólnie z TU Chemnitz i Silicon Saxony, poświęconym zaawansowanemu packagingowi elektroniki oraz integracji heterogenicznej.

IEEE Build-Up Substrate Symposium (BUSS) (Silicon Valley, USA, maj 2026)

Podczas IEEE BUSS 2026 Urs Berger wygłasza prezentację pt. „Micron-Level Dispensing for the Next Generation PCB & Display Repair”, dotyczącą wykorzystania technologii Ultra-Precise Dispensing w naprawie ultra-cienkich struktur przewodzących w zaawansowanych wyświetlaczach i UHD PCB.

IMAPS IBERIA 2026 Barcelona, Hiszpania, czerwiec 2026)

XTPL bierze udział w wydarzeniu IMAPS IBERIA 2026, prezentując rozwiązania Spółki dla rynku zaawansowanej mikroelektroniki i technologii półprzewodnikowych.

NextFlex Innovation Day 2026 (Mountain View, USA, czerwiec 2026)

XTPL bierze udział w wydarzeniu NextFlex Innovation Day 2026 z własnym stoiskiem. Spółkę reprezentuje Urs Berger, prezentując rozwiązania XTPL dla rynku zaawansowanej elektroniki i mikroelektroniki.

TechBlick USA 2026 (Mountain View, USA, czerwiec 2026)

XTPL Inc. bierze udział w wydarzeniu TechBlick USA 2026 z własnym stoiskiem. Spółkę reprezentują Urs Berger oraz Kyle Homan, prowadząc działania związane z prezentacją technologii XTPL oraz rozwojem relacji biznesowych na rynku północnoamerykańskim.

JPCA Show 2026 (Tokio, Japonia, czerwiec 2026)

XTPL reprezentują w targach JPCA Show 2026 partnerzy Alpha oraz PEC, prezentując rozwiązania Spółki dla zaawansowanych zastosowań PCB i mikroelektroniki.

MINaPAD Forum 2026 (Grenoble, Francja, czerwiec 2026)

XTPL weźmie udział w konferencji MINaPAD 2026 poświęconej zaawansowanym technologiom mikroelektronicznym i packagingowi. Podczas wydarzenia Filip Graneł wygłosi prezentację pt.:

„Ultra-Precise Dispensing for Advanced Microelectronics Packaging: Materials Versatility and Long-Term Process Stability”. Prezentacja będzie dotyczyć technologii Ultra-Precise Dispensing w kontekście zaawansowanego packagingu mikroelektroniki, ze szczególnym uwzględnieniem kompatybilności materiałowej oraz długoterminowej stabilności procesu.

OE-A Meeting North America (Mountain View, Ca, USA, czerwiec 2026) Przedstawiciel XTPL uczestniczył w spotkaniu stowarzyszenia OE-A (Organic and Printed Electronics Association), które zrzesza firmy i instytuty badawcze z branży elektroniki drukowanej, organicznej i elastycznej.

EPOSS Annual Forum 2026 (Braga, Portugalia, czerwiec 2026) XTPL uczestniczyło w EPoSS Annual Forum 2026, dorocznym spotkaniu europejskiej platformy technologicznej zajmującej się integracją inteligentnych systemów. Podczas wydarzenia przedstawiciel XTPL wygłosił prezentację pt. „Ultra-Precise Dispensing as a Circuit Editing Tool in Advanced Semiconductor Packaging”, dotyczącą zastosowania technologii XTPL do korekty obwodów w zaawansowanym packagingu półprzewodników.

Laser Sintering Workshop Hamamatsu / Fraunhofer ENAS (Chemnitz, Niemcy, czerwiec 2026) Przedstawiciel XTPL uczestniczył w warsztatach o druku cyfrowym elektroniki i laserowym spiekaniu tuszów funkcjonalnych, zorganizowanych przez Fraunhofer ENAS wspólnie z Hamamatsu Photonics.

WAT - Wojskowa Akademia Techniczna (Warszawa, Polska, czerwiec 2026) Przedstawiciele XTPL odwiedzili Wojskową Akademię Techniczną, która prowadzi badania m.in. w optoelektronice, technice laserowej i technologiach dla sektora obronnego, aby omówić możliwości współpracy badawczej.

Wydarzenia branżowe po Dniu Bilansowym

U.K Semiconductors 2026 (Sheffield, U.K., lipiec 2026) XTPL wzięło udział w konferencji UK Semiconductors 2026, dorocznym brytyjskim spotkaniu poświęconym badaniom nad półprzewodnikami, od materiałów i przyrządów po zastosowania komercyjne. Spółka była obecna jako partner sponsorujący wraz z brytyjskim dystrybutorem Semitronics.

SEMICON Taiwan 2026 (Tajpej, Tajwan, wrzesień 2026)

Spółka planuje udział w targach SEMICON Taiwan 2026 wraz z partnerem Sigma oraz przy wsparciu PAIH. XTPL będzie prezentować rozwiązania dla rynku zaawansowanej mikroelektroniki i półprzewodników.

IMAPS 2026 (Bukowina Tatrzańska, Polska, wrzesień 2026)

XTPL bierze udział w konferencji iMAPS 2026 z własnym stoiskiem, prezentując rozwiązania Spółki dla rynku zaawansowanej mikroelektroniki i elektroniki hybrydowej.

IMAPS Symposium 2026 (Boston, USA, wrzesień-październik 2026)

XTPL uczestniczy w konferencji IMAPS Symposium 2026 z własnym stoiskiem. Spółkę reprezentuje Urs Berger, prowadząc działania związane z prezentacją technologii XTPL oraz rozwojem relacji biznesowych na rynku północnoamerykańskim.

TechBlick Europe 2026 (Berlin, Niemcy, październik 2026)

XTPL bierze udział w wydarzeniu TechBlick Europe 2026 z prezentacją oraz stoiskiem wystawienniczym, prezentując technologię Ultra-Precise Dispensing dla zastosowań elektroniki addytywnej i zaawansowanej mikroelektroniki.

Australian National Fabrication Facility (ANFF) Annual Forum 2026 (Australia, październik 2026)

XTPL planuje udział w wydarzeniu ANFF Annual Forum 2026 wraz z partnerem dystrybucyjnym. Obecność Spółki obejmuje stoisko wystawiennicze oraz planowaną prezentację dotyczącą technologii XTPL i jej zastosowań w zaawansowanej mikroelektronice.

SEMICON Europa 2026 (Monachium, Niemcy, listopad 2026)

Spółka uczestniczy w targach SEMICON Europa 2026 z własnym stoiskiem, prowadząc działania związane z prezentacją technologii XTPL oraz rozwojem relacji biznesowych w europejskim sektorze półprzewodników i advanced packaging.

MRS Fall Meeting 2026 (Boston, USA, Listopad-grudzień 2026)

XTPL bierze udział w konferencji MRS Fall Meeting 2026. Podczas wydarzenia Urs Berger prezentuje rozwiązania i technologie XTPL dla zaawansowanej mikroelektroniki i zastosowań materiałowych.

SEMICON Japan 2026 (Tokio, Japonia, grudzień 2026)

XTPL uczestniczy w targach SEMICON Japan 2026 z własnym stoiskiem, również w ramach inicjatywy EU Business Hub, prezentując rozwiązania Spółki dla rynku zaawansowanej mikroelektroniki i półprzewodników.

OE-A delegation to India(New Delhi, Pune, Bengaluru, India, wrzesień 2026) XTPL weźmie udział w misji gospodarczej stowarzyszenia OE-A do Indii. W jej ramach przedstawiciel XTPL wygłosi prezentację podczas sympozjum „OE-A Symposium on Flexible and Printed Electronics: From Technology to Smart Applications” na targach electronica/productronica India w Bengaluru. Celem misji jest nawiązanie relacji z indyjskim rynkiem elektroniki.

MNE Micro+Nano Engineering Conference (Interlaken, Switzerland, wrzesień 2026) XTPL weźmie udział w 52. konferencji Micro and Nano Engineering, europejskim spotkaniu poświęconym mikro- i nanowytwarzaniu oraz jego zastosowaniom w elektronice i fotonice. W programie konferencji znajduje się plakat współautorstwa zespołu XTPL pt. „Additive Manufacturing of MicroLED Color Conversion Modules via Ultra-Precise Dispensing”.

Binghamton University Electronics Packaging Symposium (Binghamton NY, USA, wrzesień 2026) Przedstawiciel XTPL uczestniczy w 37. sympozjum poświęconym packagingowi elektroniki na Binghamton University, organizowanym we współpracy z IEEE Electronics Packaging Society. Tegoroczna edycja dotyczy packagingu dla zastosowań sztucznej inteligencji.

MSPO (Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego) (Kielce, Poland, wrzesień 2026) XTPL bierze udział w 34. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, największych targach przemysłu obronnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas wydarzenia przedstawiciel XTPL w ramach sesji Photonics4Defense przedstawi wystąpienie pt. „Transparent EMI Shielding Printed on Curved Optics for Defense Applications”.

Misja sektora dual-use do Norwegii: Oslo i Kongsberg (Oslo, Norwegia, wrzesień 2026) Przedstawiciel XTPL weźmie udział w misji gospodarczej sektora technologii podwójnego zastosowania, organizowanej przez PAIH we współpracy z Ambasadą RP w Oslo. Misja obejmie spotkania z norweskim przemysłem obronnym i technologicznym, w tym w ośrodku przemysłowym w Kongsbergu.

Taitronics 2026- Stoisko narodowe (Taipei, Taiwan, październik 2026) XTPL weźmie udział w targach TAITRONICS (Taipei International Electronics Show) na stoisku narodowym organizowanym przez PARP, prezentując rozwiązania Spółki dla rynku elektroniki profesjonalnej i mikroelektroniki.

Industrial Print Integration Conference (Neuss, Germany, listopad 2026) Przedstawiciel XTPL weźmie udział w konferencji IPI, organizowanej przez stowarzyszenie ESMA, poświęconej wdrażaniu druku przemysłowego i funkcjonalnego m.in. w elektronice, motoryzacji i zastosowaniach biomedycznych.

iMAPS U.K (The RF, Microwave and Photonics Packaging)(Newport, U.K., listopad 2026) XTPL weźmie udział w konferencji IMAPS UK RaMPoP (RF, Microwave and Photonics Packaging), poświęconej packagingowi i montażowi układów RF, mikrofalowych i fotonicznych.

IMAPS Italy Workshop – High Reliability Packaging for Avionics, Aerospace & Defense (Milan, Italy, listopad 2026) XTPL weźmie udział w warsztatach IMAPS Italy na Politecnico di Milano, poświęconych packagingowi o wysokiej niezawodności dla awioniki, przemysłu kosmicznego i obronnego. Przedstawiciel XTPL wygłosi wystąpienie pt. „Additive Manufacturing of 1–10 µm Metal Structures for RF and Microwave Interconnects and EMI Shielding”.

5.9.7 Pozostałe

W okresie sprawozdawczym Pani Agata Gładysz-Stańczyk złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z efektem natychmiastowym, wskazując jako powód nowe obowiązki zawodowe (komunikat ESPI nr 23/2026 z dnia 22 kwietnia 2026 roku).

W dniu 30 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Członków Komitetu Audytu do nowej kadencji w składach:

Zarząd:

1. Filip Granek – Prezes Zarządu,
2. Jacek Olszański – Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza:

1. Wiesław Rozłucki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Bartosz Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

3. Beata Turlejska – Członek Rady Nadzorczej,
4. Piotr Lembas – Członek Rady Nadzorczej,
5. Herbert Wirth – Członek Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu:

1. Piotr Lembas – Przewodniczący Komitetu Audytu, niezależny Członek KA,
2. Dr Wiesław Rozłucki – Członek Komitetu Audytu, niezależny Członek KA,
3. Prof. dr hab. Herbert Wirth – Członek Komitetu Audytu, niezależny Członek KA

o czym poinformowała Spółka w swoim komunikacie ESPI nr 25/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku.

Skład Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu do dnia sporządzenia Raportu pozostał bez zmian.

5.9.8 Zdarzenia po Dniu Bilansowym

Zarząd XTPL S.A. poinformował, że w dniu 3 lipca 2026 r. Spółka potwierdziła przyjęcie zamówienia na urządzenie Delta Printing System wraz z dedykowanym systemem laserowym umożliwiającym spiekanie laserowe wydrukowanych ścieżek miedzianych, złożonego przez nowego partnera przemysłowego z Japonii, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (komunikat ESPI nr 30/2026 z dnia 3 lipca 2026 roku).

Zamawiającym jest japoński producent zaawansowanych, zautomatyzowanych maszyn przemysłowych dla globalnego sektora elektroniki i technologii półprzewodnikowych, posiadający kilkudziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu i dostarczaniu takich rozwiązań na wielu rynkach na świecie. Urządzenie DPS pełni funkcję laboratoryjnego demonstratora technologii Ultra-Precise Dispensing ["UPD"] oraz narzędzia do jej samodzielnej walidacji przez Klienta. Wraz z dedykowanym systemem laserowym zostanie wykorzystane w procesach yield management (poprawy uzysków produkcyjnych) dla zaawansowanych struktur stosowanych w obszarze zaawansowanego pakowania (advanced packaging) w tym zaawansowanych obwodów drukowanych HDI/UHDI PCB oraz podłoży dla półprzewodników z użyciem miedzi jako materiału przewodzącego.

Zamówienie jest konsekwencją pomyślnej walidacji technologii przeprowadzonej wspólnie przez Klienta i XTPL w laboratorium Spółki we Wrocławiu i wiąże się z przejściem projektu do trzeciego z pięciu etapów procesu wdrożeń przemysłowych XTPL, w ramach którego Klient rozpoczyna samodzielną walidację technologii Spółki we własnym laboratorium badawczo-rozwojowym. W przypadku pozytywnych wyników kolejny etap obejmuje zamówienie modułu UPD oraz jego integrację w prototypowej maszynie przemysłowej Klienta (etap czwarty), poprzedzającą decyzję o pełnym wdrożeniu przemysłowym technologii XTPL (etap piąty).

Jest to kolejna sprzedaż produktu XTPL do Japonii oraz drugi - obok projektu raportowanego w czerwcu 2026 roku - niezależny projekt przemysłowy Spółki na tym rynku. Emitent informował o pierwszej sprzedaży modułu UPD do Japonii, obejmującej projekt na czwartym etapie procesu wdrożenia przemysłowego, w którym moduł UPD jest integrowany z prototypową maszyną przemysłową klienta (RB 26/2026 z dnia 11 czerwca 2026 r.). Obecne zamówienie dotyczy kolejnego Klienta i znajduje się na wcześniejszym, trzecim etapie tego procesu, jednak w zbliżonym, strategicznym obszarze zastosowań. Równoległy rozwój dwóch niezależnych projektów przemysłowych na rynku japońskim potwierdza powtarzalność modelu komercyjnego XTPL oraz rosnące zainteresowanie technologią Spółki w obszarze półprzewodników i advanced packaging.

Sprzedaż jest wspierana przez lokalnego dystrybutora XTPL w Japonii, firmę PEC (Printed Electronics Corporation). Dostawa urządzenia DPS wraz z systemem laserowym planowana jest w drugim półroczu 2026 roku i w tym okresie Spółka zakłada rozpoznanie przychodu z jego sprzedaży. Przychody uzyskane z realizacji zamówienia będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe XTPL S.A. osiągnięte w 2026 roku, a potencjał dalszej współpracy może stanowić istotną przesłankę do dalszego wzrostu sprzedaży w przyszłych okresach.

W ramach rozwoju i komercjalizacji modułów UPD, Spółka potwierdziła przyjęcie zamówienia na 10 modułów UPD w obszarze technologii nowoczesnych wyświetlaczy (FPD) w ramach kontynuacji pierwszego wdrożenia

przemysłowego technologii XTPL w Chinach (komunikat ESPI nr 32/2026 z dnia 23 lipca 2026 roku). Urządzenia zostaną wykorzystane do budowy kolejnych maszyn przemysłowych pracujących na linii produkcyjnej klienta końcowego - jednego z największych producentów wyświetlaczy FPD (Flat Panel Display) w Chinach. Moduły UPD zostaną wykorzystane w procesach yield management (poprawy uzysków produkcyjnych) w nowoczesnych wyświetlaczach FPD (ang. Flat Panel Display) o ultrawysokiej rozdzielczości. Zamówienie stanowi kolejny etap pierwszego w historii Emitenta wdrożenia przemysłowego technologii UPD, zapoczątkowanego w styczniu 2025 roku, w ramach którego Spółka zrealizowała zamówienie na pierwszą partię 6 modułów UPD, dostarczonych Klientowi Końcowemu i pomyślnie zintegrowanych z przemysłowymi urządzeniami do procesów yield management (RB ESPI 1/2025 z dnia 3 stycznia 2025 r.). Obecne zamówienie potwierdza kontynuację tej współpracy w ramach wieloletniego projektu wdrożeniowego.

W dniu 17 sierpnia 2026 roku doszło do rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu Spółki wynikających z uchwały nr 16/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie zmian statutu XTPL S.A. (komunikat ESPI nr 33/2026 z dnia 20 sierpnia 2026 roku).

Na mocy Uchwały Emisyjnej dokonano zmian: § 4, § 8, § 14, § 15, § 19, § 20 i § 21 statutu Spółki.

Zarząd XTPL S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2025 z dnia 25 września 2025 roku dotyczącego aktualizacji Strategii Spółki oraz raportu bieżącego ESPI nr 3/2026 z dnia 9 lutego 2026 roku dotyczącego zamiaru pozyskania finansowania i zainicjowania procesu emisji akcji, informuje o podjęciu w dniu 1 września 2026 roku decyzji o rozpoczęciu działań zmierzających do: (i) pozyskania dalszego finansowania Spółki poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji oraz (ii) zapewnienia Spółce możliwości elastycznego pozyskiwania finansowania w przyszłości poprzez ustanowienie kapitału docelowego (komunikat ESPI nr 34 z dnia 1 września 2026 roku oraz komunikat ESPI z późniejszą zmianą założeń nr 36/2026 z dnia 18 września 2026 roku).

Intencją Zarządu Spółki jest zwołanie na dzień 19 października 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (komunikat ESPI nr 38 z dnia 18 września 2026 roku), które miałyby zadecydować w szczególności o: (i) podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii Z w trybie subskrypcji prywatnej, realizowanej w drodze oferty publicznej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii Z do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii Z oraz umocowania do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii Z w depozycie papierów wartościowych (ii) oraz przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej (iii) i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

5.10 Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe

W Okresie Sprawozdawczym czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe, nie wystąpiły.

5.11 Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji prognoz finansowych

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w Raporcie w stosunku do wyników prognozowanych, tj. wstępnych szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług osiągniętych przez Spółkę w II kwartale 2026 roku i I półroczu 2026 roku, opublikowanych w raporcie bieżącym ESPI numer 31/2026 z dnia 22 lipca 2026 roku jest następujące: Podane do publicznej wiadomości dane wstępne nie odbiegały znacząco od danych rzeczywistych.

5.12 Istotne postępowania przed sądami i organami

W okresie Sprawozdawczym nie toczyły się istotne postępowania przed sądem i innymi organami publicznymi.

5.13 Transakcje z podmiotami powiązanymi na warunkach nierynkowych

Nie dotyczy. W ramach Grupy Kapitałowej nie zawarto żadnej transakcji z podmiotem powiązanym na warunkach innych niż rynkowe.

5.14 Udzielone poręczenia i gwarancje

Nie dotyczy. Emitent lub Jednostka Zależna nie udzieliły w Okresie Sprawozdawczym poręczeń kredytu ani pożyczki ani też nie udziwały gwarancji.

5.15 Zatrudnienie i informacje o zespole pracowniczym Emitenta

Spółka zatrudniała na Dzień Bilansowy 49 osób.

Grupa zatrudniała na Dzień Bilansowy 51 osób.

Nasz Zespół:

Rozwój technologii ultraprecyzyjnego druku XTPL jest sukcesem całego zespołu Spółki, który z wykorzystaniem swojej interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczenia zdobywa kolejne cele technologiczne i biznesowe. Efekty postępów technologicznych to rezultat intensywnej współpracy inżynierów i specjalistów łączących kompetencje wielu obszarów technologii, biznesu oraz działań operacyjnych.

To, co wyróżnia zespół technologiczny XTPL to interdyscyplinarna wiedza z dziedzin takich jak fizyka, optyka, chemia, mechanika, elektronika i programowanie. Zespół technologiczny stanowi 36,73% wszystkich pracowników i realizuje prace w poszczególnych laboratoriach: Aplikacyjnym, Nanotuszów i Nanomateriałów, Hardware oraz Software. Istotną rolę w procesie wdrażania rozwiązań pełni dział Produkcji i Customer Care, który odpowiada za produkcję urządzeń, realizację procesów montażu i testowania urządzeń oraz zapewnienia ich najwyższej jakości.

Zespół technologiczny wspierany jest przez zespół operacyjny, który zapewnia funkcjonowanie w zakresie finansów, prawa, HR, zamówień, IT oraz zarządzania projektami. Jednocześnie, działania marketingowe i PR/IR realizowane są przez dział Marketingu. Zdobywaniem nowych rynków oraz relacjami z klientami zajmuje się zespół sprzedażowy, a kompleksowe wsparcie użytkowników oraz partnerską współpracę na etapie posprzedażowym zapewnia zespół Wdrożeń i Customer Care.

Kobiety stanowiły 38,78% pełnego zespołu XTPL. Jednocześnie, w zespole technologicznym udział kobiet wynosił 27,78%.

Szkolenia i rozwój zespołu:

Szkolenia rozwijające kompetencje pracowników są realizowane w uzgodnieniu z zespołem liderów oraz zarządem Spółki. Znaczna część szkoleń organizowana jest z inicjatywy pracowników. Rozwój zespołu XTPL zapewnia regularne uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz wydarzeniach branżowych organizowanych stacjonarnie oraz online.

Benefity:

XTPL oferuje swoim pracownikom pakiet benefitów, który jest programem świadczeń pozapłacowych. XTPL oferuje: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na zdrowie i życie, program nagród za zgłoszenia patentowe, program poleceń pracowniczych, możliwość pracy zdalnej (w zależności od charakteru stanowiska pracy) oraz dostęp do firmowej biblioteki XTPL.

5.16 Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta i Grupy Kapitałowej

Spółka notuje stałe postępy w obszarze najbardziej zaawansowanych projektów przemysłowych oraz rosnący pipeline projektów przemysłowych na niższych etapach rozwoju, realizowanych w kluczowych branżach (półprzewodniki, zaawansowane wyświetlacze, PCB) oraz w kluczowych rynkach geograficznych (Azja, Ameryka Północna, Europa). Na dzień dzisiejszy na rynku operuje ponad 45 urządzeń DPS i 15 modułów przemysłowych. Ponadto Spółka znajduje się w zaawansowanej fazie prac związanych z dostarczeniem systemu ODRA, z przeznaczeniem do produkcji w modelu HMLV (High-Mix Low-Volume). W I półroczu 2026 roku Spółka zwiększyła swoje portfolio projektów przemysłowych sprzedając urządzenie DPS oraz UPD dwóm klientom z rynku japońskiego, działającym w obszarze yield management dla zaawansowanych obwodów drukowanych (HDI/UHDI PCB) oraz podłoży dla półprzewodników w obszarze advanced packaging. Równoległy rozwój dwóch niezależnych projektów przemysłowych na rynku japońskim potwierdza powtarzalność modelu komercyjnego XTPL oraz rosnące zainteresowanie technologią Spółki w obszarze półprzewodników i advanced packaging. Ponadto w lipcu 2026 (RB 32/2026 z dnia 23 lipca 2026) Spółka potwierdziła przyjęcie zamówienia ramowego obejmującego 10 modułów UPD, które zostaną wykorzystane do budowy kolejnych maszyn przemysłowych pracujących na linii produkcyjnej klienta końcowego - jednego z największych producentów wyświetlaczy FPD w Chinach. Zamówienie stanowi kolejny etap pierwszego w historii Spółki wdrożenia przemysłowego technologii UPD, zapoczątkowanego w styczniu 2025 roku, w ramach którego Spółka zrealizowała zamówienie na pierwszą partię 6 modułów UPD, dostarczonych klientowi końcowemu i pomyślnie zintegrowanych z przemysłowymi urządzeniami do procesów yield management (RB ESPI 1/2025 z dnia 3 stycznia 2025 r.). Obecne zamówienie potwierdza kontynuację tej współpracy w ramach wieloletniego projektu wdrożeniowego. Jednocześnie dynamika pierwszego wdrożenia przemysłowego jest niższa niż pierwotnie zakładano, a klienci Spółki sygnalizują raportowane do nich czasowe przesunięcie w stosunku do pierwotnie komunikowanych do Spółki założeń dotyczących horyzontu czasowego potrzeby rynkowej związanej kolejnymi węzłami generacyjnymi produktów, wymagającymi wysokorozdzielczego druku. W konsekwencji proces konwersji na sprzedaż pozostałych aktywnych projektów przemysłowych może wydłużyć się w czasie.

Ze względu na dłużej trwające procesy komercjalizacji, Zarząd Spółki zidentyfikował lukę kapitałową w 2026 roku. W celu zabezpieczenia finansowania na rok 2026 Zarząd sygnalizował w RB 27/2025 z dnia 25 września 2025 r. prowadzenie czterech równoległych procesów w obszarach:

- finansowanie dłużne;

- współfinansowanie prac B+R środkami z programów dotacyjnych;
- pozyskanie inwestora strategicznego, który objąłby mniejszościowy udział w Spółce;
- podwyższenie kapitału i emisja akcji skierowana do rynku.

Jako najbardziej prawdopodobną ścieżkę sfinansowania rozwoju Spółki Zarząd upatruje w kombinacji wszystkich powyższych form, różniących się wartością i okresem uruchomienia. W dniach 10-12 marca 2026 r. Spółka przeprowadziła emisję 300 000 akcji zwykłych na okaziciela. W procesie budowania księgi popytu ustalona została cena emisyjna na poziomie 65 zł za akcję. W efekcie w ramach emisji akcji Spółka pozyskała 19,5 mln zł brutto. Celem emisji było sfinansowanie rozwoju Spółki poprzez kontynuację realizacji projektów przemysłowych i związanych z nimi dalszych prac B+R, rozwój nowych produktów, w tym ODRA, kolejnych generacji modułów drukujących i tuszów drukujących, rozwój struktur sprzedażowych, intensyfikację działań marketingowych, utrzymanie bezpiecznego poziomu zapasów. Powyższe działania, w ocenie Zarządu, skutkować powinny osiągnięciem 100 mln zł sprzedaży oraz osiągnięciem trwałej rentowności Spółki do roku 2028. Ponadto w dniu 11 marca 2026 r. Emitent otrzymał informację o rekomendowaniu do dofinansowania w konkursie FENG.05.01-IP.01-004/25, Ścieżka B: Technologie cyfrowe i innowacje w ramach głębokich technologii, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projektu opracowanego przez Emitenta pt. "Opracowanie addytywnej technologii integracji fotonicznych układów scalonych dla zastosowań w sztucznej inteligencji". Głównym założeniem Projektu jest opracowanie, budowa i walidacja prototypu nowej generacji systemu drukującego, przeznaczonego do heterogenicznej integracji fotonicznych i elektronicznych układów scalonych (PIC + EIC) w ramach procesów zaawansowanego pakowania (Advanced Packaging). Opracowana technologia stanowić będzie element europejskiego łańcucha wartości w obszarze zaawansowanych półprzewodników. Rekomendowana wartość dofinansowania: 10 mln zł istotnie wesprze prace B+R nad nowymi produktami do końca 2029 roku.

W dniu 1 września Spółka poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego z potencjalnym tajwańskim inwestorem branżowym, posiadającym doświadczenie w inwestycjach w obszarze półprzewodników (RB 34/2026 z dnia 1 września 2026). Zgodnie z listem intencyjnym inwestor branżowy wyraził zainteresowanie inwestycją kapitałową w Spółkę polegającą na objęciu nowych akcji, tj. 198.462 akcji zwykłych na okaziciela serii Z, po cenie emisyjnej 65,00 zł za jedną akcję, za łączną cenę emisyjną wynoszącą 12,9 mln zł. Potencjalne zaangażowanie się inwestora branżowego pozytywnie wpłynie na pozycję gotówkową Spółki, a także wzmocni relacje biznesowe na rynku azjatyckim. W dniu 18 września Spółka opublikowała raport (RB 36/2026) o zmianie założeń dla emisji, zmieniając część założeń tj. ilość oferowanych akcji do przedziału nie mniej niż 198.462 i nie więcej niż 400.000 akcji oraz rozszerzając ofertę objęcia akcji o dotychczasowych akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 0,5% ogólnej liczby akcji Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 19 października 2026 roku. Intencją Zarządu jest, aby emisja akcji serii Z została przeprowadzona w taki sposób, aby akcjonariusze Spółki posiadający co najmniej 0,5% ogólnej liczby akcji Spółki [każdy indywidualnie] według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Nowym NWZ mieli możliwość skorzystania z pierwszeństwa w objęciu akcji serii Z w liczbie umożliwiającej danemu inwestorowi uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki niż udział, jaki ten inwestor uprawniony posiadał na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ. Oznacza to dla Spółki potencjalnie wyższe od pierwotnie zakładanych wpływy z planowanej emisji akcji.

Środki pozyskane z emisji akcji oraz dotacji stabilizują sytuację finansową Emitenta na co najmniej najbliższe 12 miesięcy, ale Spółka wciąż jest aktywna w pozyskaniu pozostałych form finansowania. Trwają rozmowy z instytucjami oferującymi finansowanie dłużne, na różnych etapach zaawansowania. Biorąc pod uwagę powyższe, na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania Zarząd nie stwierdza istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.

5.17 Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięcie przez Emitenta i Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Czynniki mogące mieć wpływ na działalność i wyniki Spółki i Grupy w kolejnych kwartałach:

- Podpisanie komercyjnych umów i postępy prac w zakresie płatnej ewaluacji, licencjonowania lub umów typu joint-development w zakresie rozwijanej przez emitenta technologii;
- Zdolność do odpowiedniej ochrony i zabezpieczenia własności intelektualnej i przemysłowej w tym liczba i zakres złożonych wniosków patentowych;
- Koniunktura w branży elektronicznej;
- Pozyskanie dodatkowego finansowania w postaci grantów i dotacji wspierających działalność badawczo rozwojową Emitenta;
- Ekonomiczne skutki wojny na Ukrainie;
- Ekonomiczne skutki w związku z sytuacją polityczno-gospodarczą w regionie Bliskiego Wschodu;
- Sytuacja na rynkach finansowych.

5.18 Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego

5.18.1 Czynniki ryzyka i zagrożenia związane z otoczeniem, w ramach którego Spółka i Grupa prowadzi działalność

5.18.1.1 Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym

Działalność Spółki i Grupy uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej panującej na rynkach, na których Spółka planuje rozpocząć sprzedaż produktów i świadczenie usług, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie Zachodniej. Stopień rentowności prowadzonej przez Spółkę działalności będzie uzależniony między innymi od występującego w tych krajach tempa wzrostu gospodarczego, poziomu konsumpcji i inwestycji (zwłaszcza w przemyśle elektronicznym), polityki fiskalnej i pieniężnej, poziomu inflacji, a w szczególności poziomu wydatków na elektronikę użytkową. Wszystkie te czynniki mogą wywierać wpływ na osiągane przez Spółkę i Grupę wyniki finansowe, a tym samym mogą także wywierać wpływ na realizację założonej przez Spółkę strategii rozwoju.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.1.2 Ryzyko walutowe

Ze względu na fakt, iż odbiorcami Spółki i Grupy są podmioty międzynarodowe, większość przychodów Spółki związanych z komercjalizacją technologii jest rozliczana w walutach obcych (głównie euro i dolar amerykański). Równocześnie, z uwagi na lokalizację Spółki w Polsce, większość kosztów bieżącej działalności rozliczana jest w walucie krajowej. W związku z tym Spółka może być narażona na istotne ryzyko kursowe. Zmienność kursów walutowych może wpływać przede wszystkim na zmiany wartości przychodów oraz należności Spółki w przeliczeniu na PLN.

Mimo znaczącego osłabienia się polskiej waluty, związanego z wybuchem wojny w Ukrainie, Spółka i Grupa nie postrzegają ryzyka kursowego jako istotnego zagrożenia dla poziomu zakładanej rentowności działalności operacyjnej. Osłabienie się złotówki wzmacnia pozycję gotówkową Spółki jako eksportera. Istotna część zakupów materiałów i podzespołów do produkcji drukarek realizowana jest w walucie euro, dzięki czemu przychody ze sprzedaży w walucie stanowią naturalne zabezpieczenie przed wahaniami kursu. W przypadkach tego wymagających, Spółka i Grupa będzie wykorzystywała dostępne na rynku bankowym instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.1.3 Ryzyko związane z rozwojem nowych technologii

Rynek, na którym Spółka i Grupa prowadzą działalność cechuje się szybkim rozwojem wykorzystywanych technologii, stąd też rozwój działalności Spółki i Grupy wiąże się z koniecznością stałego monitorowania i analizowania nowych trendów rynkowych oraz identyfikowania nowych potencjalnych konkurentów i wdrażanych przez nich rozwiązań technologicznych. Istnieje ryzyko, iż w przypadku zmiany aktualnych trendów rynkowych, Spółka i Grupa będzie zmuszona do poszukiwania nowych zastosowań technologii poza obszarem dotychczas uważanym za core business lub do poniesienia nakładów na dotychczasowe rozwiązania celem zwiększenia ich konkurencyjności. Spółka i Grupa nie może również wykluczyć, iż w przyszłości zostanie opracowana nowa technologia, w obliczu której rozwiązania proponowane przez Spółkę i Grupę przestaną być atrakcyjne dla potencjalnych odbiorców. Realizacja opisywanego ryzyka będzie związana z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, co negatywnie odbije się na rentowności działalności Spółki i Grupy. Ponadto, konieczność dokonania dodatkowych prac może opóźnić moment komercjalizacji produktów Spółki i Grupy.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni

5.18.1.4 Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym

Spółka i Grupa działa na bardzo atrakcyjnym rynku nowoczesnych technologii charakteryzującym się stale rosnącym popytem. Na rynku tym działalność prowadzi szereg podmiotów dysponujących znacznie większym doświadczeniem oraz zasobami kapitałowymi niż Spółka. Ze względu na dużą dynamikę rynku, istnieje także ryzyko pojawienia się nowego podmiotu, którego oferta będzie bardziej innowacyjna od oferty Spółki i Grupy. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest możliwe poprzez wdrożenie innowacyjnych, unikalnych rozwiązań atrakcyjnych użytkowo i ekonomicznie dla potencjalnych odbiorców.

Obecnie, Spółce nie są znane rozwiązania, które pod względem technicznym oferowałyby lepsze parametry ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów. Nie można jednak wykluczyć, że pojawi się nowy podmiot lub nowe rozwiązanie, które przewyższać będzie rozwijaną technologię w niektórych albo we wszystkich, kluczowych parametrach. Istnieje również ryzyko, że Spółka i Grupa Kapitałowa nie będzie w stanie wystarczająco szybko ani skutecznie zareagować na zmieniające się otoczenie rynkowe, w konsekwencji oferowane przez Spółkę i Grupę rozwiązania zostaną uznane za mniej konkurencyjne. Ziszczenie się tego ryzyka może mieć negatywny wpływ na sprzedaż produktów i usług Spółki i Grupy Kapitałowej oraz w konsekwencji na osiągnięte przez nią wyniki finansowe.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni

5.18.1.5 Ryzyko związane z rozwojem pandemii SARS-CoV-2

Ze względu na rynek, na którym działa Spółka, sytuacja związana z zagrożeniem epidemiologicznym nie wpływa co do zasady na działalność operacyjną Emitenta. Spółka opracowała szereg procedur uzależnionych od poziomu zagrożenia i stosuje je adekwatnie do sytuacji. Pracownicy biurowi mogą wykonywać swoje obowiązki zdalnie (pracownicy biurowi mają zapewniony służbowy telefon z dostępem do Internetu oraz służbowy laptop). Pracownicy technologiczni pracują z zachowaniem wszystkich norm ogłaszanych przez instytucje państwowe. Część pracowników technologicznych zaangażowana jest w tworzenie kolejnych wniosków dotacyjnych, w związku z czym również częściowo może pracować zdalnie. Wszelkie spotkania odbywają się co do zasady z wykorzystaniem video- lub telekonferencji. Planowane działania operacyjne związane z wysyłką produktów przebiegają zgodnie z wymogami kraju docelowego.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.1.6 Źródła zaopatrzenia

Spółka komercjalizuje i rozwija autorską technologię nanodruku. Poziom zaawansowania tej technologii sprawia, że korzysta ona z szerokiego zakresu produktów i usług dostępnych na rynku. Najważniejsze pozycje wśród nich zajmują usługi pomiarowe, badawcze, opracowania formulacji nanotuszków przewodzących, ochrony patentowej, a także wynajmu specjalistycznego sprzętu i laboratoriów. Duża różnorodność i zmienność, którymi charakteryzują się realizowane prace badawczo-rozwojowe znajduje swoje odzwierciedlenie w ilości źródeł zaopatrzenia, z których korzysta Spółka. W rezultacie, w roku 2022 Spółka osiągnęła próg 56% zakupów u jednego dostawcy świadczącego usługi badawcze oraz wynajmującego laboratoria oraz pomieszczenia biurowe (100%). Jednocześnie Spółka systematycznie zwiększa park urządzeń laboratoryjnych i ogranicza zakres zlecanych zewnętrznych usług pomiarowych i badawczych.

W procesie produkcji Spółka zaopatruje się w materiały i odczynniki chemiczne, stanowiące podstawę do wytwarzania wysokoprzewodzących tuszów będących w ofercie XTPL S.A. oraz korzysta z dostawców podzespołów i materiałów w procesie produkcji urządzeń drukujących Delta Printing System.

Wśród dostawców chemii występuje duże rozproszenie. Żaden dostawca nie przekracza poziomu 20% w ogólnej sumie zakupów tej kategorii. Ponadto na rynku dostępnych jest dużo materiałów wysokiej jakości i brak jest zagrożenia uzależnienia się od jednego źródła dostaw. Co istotne zdecydowana większość materiałów chemicznych kupowana jest na rynku krajowym, więc ewentualne problemy w logistyce światowych dostaw są ograniczone.

Wśród dostawców materiałów i podzespołów do produkcji drukarek wartość dostaw jednego z dostawców osiągnęła 32% ogólnej sumy zakupów w tej kategorii. Pozostali dostawcy nie przekraczają poziomu 15%. Spółka stale nawiązuje relacje z nowymi podmiotami i buduje bazę alternatywnych dostawców.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni

5.18.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej

5.18.2.1 Ryzyko związane z procesem komercjalizacji technologii

Przyjęty przez Spółkę i Grupę model biznesowy zakłada stopniowe komercjalizowanie technologii drukowania ultracienkich linii przewodzących do różnych zastosowań w elektronice drukowanej. Obecnie komercjalizowane są urządzenia drukujące oraz nanotusze. W zakresie wdrożeń przemysłowych, na liniach produkcyjnych klientów, model biznesowy zakłada, że Spółka i Grupa komercjalizować będzie swoje rozwiązania technologiczne poprzez licencjonowanie lub zarządzać będzie całym łańcuchem wartości tj. produkcją, marketingiem produktów, dystrybucją oraz świadczeniem usług specjalistycznych dopasowanych do klienta. Wybór modelu komercjalizacji zależeć będzie od efektów negocjacji z partnerem, specyfiki danego pola aplikacyjnego oraz oceny Emitenta odnośnie efektywności każdego z możliwych sposobów komercjalizacji w danym polu.

Obecnie Spółka jest zaangażowana w 9 projektów wdrożeń przemysłowych, co potwierdza istnienie zapotrzebowania na rozwiązania, które oferuje technologia XTPL. Ponadto Spółka podpisała i realizuje umowę opracowania nanotuszu przewodzącego nowej generacji do przemysłowych zastosowań w produktach Nano Dimension Ltd. nakierowanych na produkcję płytek PCB. Umowa ta jest pierwszą umową podpisaną z partnerem przemysłowym i jest kamieniem milowym w rozwoju Spółki.

Niemniej jednak istnieje ryzyko, że wprowadzenie urządzeń na poszczególne rynki nie odbędzie się zgodnie z przyjętymi obecnie założeniami, co spowodowane będzie np. brakiem lub niedostatecznym popytem w krajach docelowych, błędnym rozpoznaniem potrzeb potencjalnych klientów, błędnym rozpoznaniem uwarunkowań prawnych, niepełnym dostosowaniem produktów Spółki do wymagań rynków zagranicznych, nieefektywną kampanią promocyjną lub niespodziewanym pojawieniem się konkurencyjnej firmy. Wystąpienie

wyżej opisanych zdarzeń może spowodować ograniczenie dynamiki rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej, negatywnie wpłynąć na jej działalność i sytuację finansową.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: wysoki

5.18.2.2 Ryzyko związane z nieosiągnięciem przychodów

Na obecnym etapie rozwoju Spółki to ryzyko należy uznać za nieistotne. Spółka w roku obrotowym znacząco zwiększyła przychody ze sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego. Głównym strumieniem tych przychodów była sprzedaż urządzeń drukujących. Spółka zamierza dynamicznie rozwijać tę grupę produktową, również poprzez budowę sieci dystrybucyjnej (zewnętrzni dystrybutorzy) na całym świecie. Jednocześnie Spółka systematycznie zwiększa przychody z tytułu sprzedaży tuszów i innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Ponadto Spółka realizuje z podmiotem przemysłowym umowę opracowania nanotuszu przewodzącego nowej generacji. W 2022 roku zostały rozpoznane z tego tytułu pierwsze przychody.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni

5.18.2.3 Ryzyko związane z odpowiedzialnością za jakość produktu

Przyjęty przez Spółkę i Grupę model biznesowy zakładający stopniowe wprowadzenie technologii drukowania ultracienkich linii przewodzących do różnych zastosowań w elektronice drukowanej niesie za sobą ryzyko usterek, niewystarczającej jakości produktu lub niezadowolającej efektywności technologii w początkowej fazie jej komercjalizacji. Istnieje możliwość, że pojawią się nieprzewidziane usterki i problemy. Wystąpienie takich sytuacji może spowodować negatywny pierwszy odbiór produktów Spółki i Grupy, a co za tym idzie, wstrzymać zainteresowanie produktem i popyt na niego. W efekcie Spółka i Grupa może nie uzyskać wpływów w spodziewanej wysokości.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: wysoki

5.18.2.4 Ryzyko związane z modelem rozwoju biznesu oraz niezrealizowaniem strategii Spółki i Grupy

Model biznesowy polega na komercjalizacji opracowywanej przez Spółkę technologii ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów. Spółka komercjalizuje już pierwsze produkty - nośniki technologii. Prowadzi również 9 projektów związanych z wdrożeniem technologii na linie produkcyjne partnerów, ale w tym obszarze, który ma największy potencjał, Spółka nie realizuje jeszcze powtarzalnego modelu biznesowego. Z uwagi na uwarunkowania geograficzne i ekonomiczne rynku, Spółka będzie rozwijała swoją obecność biznesową głównie na terenie Stanów Zjednoczonych, Azji i Europy Zachodniej. Spółka zamierza budować swoją pozycję na rynku poprzez rozwój organiczny, przede wszystkim w oparciu o dalsze rozwijanie opracowywanej technologii. Ze względu na szereg czynników, Spółka nie może w pełni zagwarantować, że przyjęty przez nią model rozwoju biznesu będzie skuteczny. Przyszła pozycja Spółki na szeroko pojmowanym rynku elektroniki drukowanej, uzależniona jest od zdolności wypracowania i wdrożenia strategii rozwoju skutecznej w długim terminie oraz dalszego rozwoju technologii. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji albo niezdolność Spółki do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych, nietrafności przyjętych założeń strategicznych, dotyczących m.in. rozwijanej technologii oraz przyjętego planu jej komercjalizacji i wielkości zapotrzebowania ze strony potencjalnych klientów, oznaczać może, iż model rozwoju biznesu nie będzie efektywny, a osiągnięte w przyszłości wyniki finansowe mogą być niższe niż obecnie zakładane.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: wysoki

5.18.2.5 Ryzyko związane z trudnościami w pozyskiwaniu doświadczonych i wyspecjalizowanych pracowników

Wysoki poziom zaawansowania technologicznego badań prowadzonych przez Spółkę powoduje, że stale zwiększają się wymagania odnośnie umiejętności i doświadczenia pracowników. Kadra inżynierska i naukowa

jest - obok technologii - najcenniejszym zasobem Spółki. Tempo i jakość prowadzonych prac badawczo-rozwojowych Spółki związana jest bezpośrednio z umiejętnościami specjalistów tworzących zespół R&D. Spółka zatrudnia inżynierów z następujących dziedzin: chemia, fizyka, elektronika, mechanika, inżynieria materiałowa, programowanie i symulacje numeryczne. Niemal w każdej z wymienionych dziedzin podaż specjalistów gotowych do podjęcia pracy nie jest duża. W zakresie pozyskiwania najlepszych specjalistów Spółka konkuruje zarówno ze spółkami w Polsce, jak i za granicą.

W sytuacji dynamicznego wzrostu skali działalności Spółki w przyszłości, czynnik ten może mieć szczególnie istotne znacznie ograniczające możliwości rozwoju. Trudności w pozyskiwaniu pracowników mogą opóźnić prace lub zmusić Spółkę do zaniechania realizacji niektórych projektów.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni

5.18.2.6 Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu

Działalność Spółki jest oparta na wąskim zespole osób, posiadających odpowiedni know-how, skupiających kompetencje w obszarze inżynierii, zarządzania technicznego i finansowego oraz strategicznego nad Spółką. W związku z tym, utrata kluczowych osób może niekorzystnie wpłynąć na dalszą działalność Spółki, jej sytuację finansową, majątkową i gospodarczą oraz perspektywy rozwoju poprzez ograniczenie możliwości sprzedaży produktów Spółki, rozwoju technologii, zdobywania nowych kontraktów oraz utrudnienia należytej obsługi kontraktów już otwartych.

Większość personelu Spółki to osoby zatrudnione na stanowiskach operacyjnych. Są to osoby wykonujące zadania, które wymagają specjalistycznej wiedzy, zdolności i wykształcenia. Spółka jest narażona na ryzyko odejścia części pracowników operacyjnych, co może skutkować osłabieniem struktury organizacyjnej, na której oparta jest działalność Spółki. Wskazane sytuacje mogą skutkować zachwianiem stabilności działania Spółki i wymóc konieczność podniesienia poziomu wynagrodzeń w celu utrzymania pracowników. W efekcie może to wpłynąć na wzrost kosztów działalności Spółki.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni

5.18.2.7 Ryzyko uzależnienia od przyszłych kontrahentów

Ze względu na specyfikę projektów wdrożeń przemysłowych (wysokie wartości kontraktów), komercjalizacja pierwszych projektów będzie powodować duże uzależnienie od poszczególnych klientów. Stąd też Spółka prowadzi projekty z wieloma partnerami, na różnych rynkach i polach aplikacyjnych.

Sprzedaż urządzeń drukujących i materiałów eksploatacyjnych nie rodzi takiego ryzyka ze względu na jednostkowy charakter transakcji w przypadku drukarek i rozproszony rynek w przypadku materiałów eksploatacyjnych.

Ze względu na fakt, iż Spółka dostarcza zaawansowane urządzenia techniczne, istnieje ryzyko uzależnienia się od dostawców materiałów i podzespołów. Spółka stara się dywersyfikować źródła dostaw i buduje relacje i bezę alternatywnych dostawców, ale należy pamiętać, że przy tak zaawansowanych technicznie urządzeniach zmiana podzespołów jest również obciążona ryzykiem w zakresie sprawności funkcjonowania produkowanych urządzeń.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni

5.18.2.8 Ryzyko związane z możliwością ujawnienia informacji poufnych w zakresie technologii

Realizacja strategii Spółki jest uzależniona m.in. od zachowania tajemnicy przez osoby będące w posiadaniu informacji poufnych, dotyczących w szczególności prowadzonych badań rozwojowych oraz procesów technologicznych związanych z technologią ultraprecyzyjnego nanodruku. Istnieje ryzyko, że wrażliwe informacje zostaną ujawnione przez osoby związane ze Spółką, czego efektem może być ich wykorzystanie

przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną, pomimo środków ochrony własności intelektualnej stosowanych przez Spółkę.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową akcji Spółki.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.2.9 Ryzyko naruszenia własności intelektualnej

Spółka prowadzi działalność w obszarze, w którym istotne znaczenie mają regulacje dotyczące praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz ich ochrony. Obecnie nie toczą się żadne postępowania w zakresie naruszenia praw własności przemysłowej i intelektualnej z udziałem Spółki. Spółka zamierza prowadzić działalność w taki sposób, by nie naruszyć praw osób trzecich w tym zakresie. Nie można jednak wykluczyć, że przeciwko Spółce będą wysuwane przez osoby trzecie roszczenia dotyczące naruszenia przez Spółkę praw własności przemysłowej i intelektualnej. Wysunięcie takich roszczeń, nawet jeżeli będą one bezzasadne, może niekorzystnie wpłynąć na harmonogram realizacji strategii Spółki, a obrona przed takimi roszczeniami może wiązać się z koniecznością ponoszenia znacznych kosztów, co w efekcie może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki. Dodatkowo Spółka podczas prac nad własnymi wnioskami patentowymi dokonuje wnikliwego przeglądu literatury oraz obecnie znanych patentów. Istnieje jednak ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej związane z patentami, które zostały zgłoszone, ale jeszcze nie opublikowane.

Podobne ryzyko niesie ze sobą współpraca z zewnętrznymi partnerami. Nieuprawnione formalnie podmioty mogą próbować wykorzystać własność intelektualną XTPL poprzez albo naruszenie zgłoszenia patentowego wprost albo poprzez próbę obejścia go. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągnięte wyniki i sytuację finansową Spółki.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni

5.18.2.10 Ryzyko związane ze skalowaniem technologii

W związku z faktem, że technologia stanowiąca podstawę procesu druku opracowywanego przez XTPL bazuje na wysoce innowacyjnych rozwiązaniach, istnieje ryzyko, iż zwiększenie skali jej wykorzystania z laboratoryjnej na przemysłową może skończyć się niepowodzeniem.

Powyższe ryzyko może się zmaterializować poprzez trudności w uzyskaniu równie stabilnych parametrów technologii w produkcji przemysłowej, jak te uzyskiwane w laboratorium. Ponadto istnieje ryzyko, że opracowana technologia może nie być wystarczająco efektywna dla niektórych procesów produkcyjnych w przemyśle (np. w wyniku nieuzyskania dostatecznej wydajności procesu produkcyjnego).

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: wysoki

5.18.2.11 Ryzyko związane z dotarciem do klienta docelowego i realizacją planów sprzedaży

Klientami XTPL będą w szczególności koncerny zajmujące się produkcją urządzeń do produkcji elektroniki. Posiadają one długie kanały komunikacyjne i decyzyjne. Istnieje ryzyko, że oferta składana przez Spółkę o krótkiej historii rynkowej, jaką jest XTPL, zostanie oceniona jako mało wiarygodna. Może to prowadzić do opóźnień w realizacji planów sprzedażowych Spółki lub nawet niepozyskania danego klienta. Jednakże wraz ze wzrostem sprzedaży, szczególnie urządzeń drukujących, systematycznie rośnie świadomość technologii XTPL zarówno u bezpośrednich odbiorców, jakimi są obecnie instytuty badawcze, jak i pośrednich, tj. przemysłowych partnerów z którymi współpracują instytuty badawcze. Ponadto sama Spółka nawiązała szereg relacji z partnerami przemysłowymi, czego efektem jest 9 projektów realizowanych z takimi partnerami.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni

5.18.2.12 Ryzyko pojawienia się konkurencyjnego rozwiązania technologicznego

Na globalnym rynku technologii stale rozwijane są nowe konkurencyjne w stosunku do XTPL rozwiązania technologiczne. Porównanie parametrów dostępnych obecnie rozwiązań z parametrami osiąganymi w ramach technologii XTPL wskazuje, w ocenie Spółki, że konkurencyjne technologie oferują rozwiązania o słabszych parametrach i często wyższym koszcie wytworzenia niż analogiczne wartości przewidywane w przemysłowym rozwiązaniu XTPL. Spółka podjęła działania mające na celu objęcie opracowywanej kompleksową technologii ochroną patentową. Na Datę Raportu ryzyko konkurencyjne Spółki można określić jako niskie, gdyż rozwijane rozwiązania są mniej efektywne od rozwiązań nad którymi pracuje Spółka. Nie można jednak wykluczyć pojawienia się na rynku rozwiązań bardziej zaawansowanych technologicznie lub bardziej efektywnych kosztowo. Istnieje również ryzyko przeznaczenia przez podmioty konkurencyjne istotnie wyższych nakładów na promocję dostępnych rozwiązań. Ryzyka te w sposób istotny mogą wpłynąć na perspektywy rozwoju Spółki.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni

5.18.2.13 Ryzyko związane z utratą płynności finansowej oraz z dostępem do finansowania

Na Datę Raportu przychody generowane przez Spółkę ze sprzedaży produktów i usług wzmocnione przychodami z tytułu dotacji są w stanie zabezpieczyć jej działalność operacyjną. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż za wyjątkiem tuszów, Spółka nie osiągnęła jeszcze stabilnych, powtarzalnych przychodów. Istnieje również ryzyko finansowania działalności w przypadku skalowania biznesu do wielkości przemysłowych. Jednakże należy brać pod uwagę możliwość pozyskiwania finansowania z kilku różnych źródeł, tj. finansowanie dłużne, projekty dotacyjne oraz finansowanie kapitałem własnym (zyski i nowe emisje akcji).

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni

5.18.2.14 Ryzyko nieotrzymania dotacji i grantów

Dotacje i granty stanowią drugie źródło (po emisjach akcji) finansowania badań i rozwoju Spółki. Istnieje ryzyko niez uzyskania dotacji i grantów w odpowiedniej wysokości, co może opóźnić prace badawczo-rozwojowe.

Niezależnie, w przeszłości Spółka zawarła umowę o dotację z NCBR, zgodnie z którą NCBR upoważniony do wypowiedzenia umowy w enumeratywnie wymienionych w umowie przypadkach, tj. m.in. w sytuacji gdy: (i) Emitent odmawia przeprowadzenia kontroli lub ją utrudnia; (ii) Emitent dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji umowy lub nie poinformował NCBR o zamiarze dokonania takich zmian; (iii) NCBR stwierdził braki w przedłożonej dokumentacji oddziaływania projektu na środowisko i nie zostaną one w wyznaczonym terminie skorygowane lub uzupełnione; (iv) beneficjent nie wywiązuje się z obowiązków informacyjnych w trakcie realizacji projektu i w jego okresie trwałości; (v) wystąpią nieprawidłowości w realizacji projektu, wskazane wprost w umowie. W związku z tym występuje ryzyko wystąpienia żądania przez NCBR zwrotu całości lub części udzielonej Spółce dotacji co może mieć wpływ na sytuację finansową Spółki.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.2.15 Ryzyko związane z wdrożeniem własnych technologii przez potencjalnych klientów Spółki

Istotną grupę potencjalnych odbiorców technologii opracowanej przez Spółkę stanowią globalni producenci komponentów do elektroniki (np. wyświetlaczy). Istnieje ryzyko, że podmioty te, posiadając znaczące zasoby techniczno-organizacyjne, mogą opracować własne rozwiązania w zakresie nanodruku, w związku z czym produkt oferowany przez Spółkę nie znajdzie się w kręgu zainteresowania tych podmiotów.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: wysoki

5.18.2.16 Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych

Spółka jest eksponowana na ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci elektrycznych, zarówno w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym naturalne, działania wojenne i inne. Mogą one skutkować zmniejszeniem efektywności działalności Spółki albo jej całkowitym wstrzymaniem. W takiej sytuacji Spółka może zostać narażona na poniesienie nieprzewidzianych kosztów.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.2.17 Ryzyko czynnika ludzkiego

W działalność produkcyjną Spółki zaangażowane są osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych. Czynności dokonywane przez te osoby w ramach pracy mogą prowadzić do powstania błędów spowodowanych nienależytym wykonywaniem przez nich ich obowiązków. Takie działania mogą mieć charakter działań zamierzonych bądź nieumyślnych i mogą one doprowadzić do zakłóceń i opóźnień w procesie komercjalizacji.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni

5.18.2.18 Ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego w działalności Spółki i Grupy Kapitałowej

Działalność Spółki opiera się w szczególności na prawidłowo działającym specjalistycznym sprzęcie. Istnieje ryzyko, iż w przypadku poważnej awarii sprzętu, która będzie niemożliwa do natychmiastowego usunięcia, Spółka może zostać zmuszona do czasowego wstrzymania części lub całości swojej działalności, aż do czasu usunięcia awarii. Awaria sprzętu może doprowadzić także do utraty danych stanowiących element pracy nad produktem Spółki. Przerwa w działalności lub utrata danych kluczowych dla danego projektu może spowodować niemożność wykonania zobowiązań wynikających z aktualnych umów, a nawet utratę posiadanych kontraktów, co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.2.19 Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową

Spółka zawiera w toku działalności umowy ubezpieczeń. Nie można jednak wykluczyć, że w działalności Spółki ziszcza się ryzyka ubezpieczeniowe w wymiarze przekraczającym zakres ochrony ubezpieczeniowej, lub wystąpią zdarzenia nieprzewidziane nieobjęte w żadnym zakresie ochroną ubezpieczeniową. Takie zdarzenia mogą mieć negatywny wpływ na wynik z działalności Spółki.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.2.20 Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi

Według dostępnych informacji, wobec Spółki nie toczy się żadne postępowanie sądowe ani administracyjne, mające istotny wpływ na jej działalność. Jednak przyszła działalność Spółki w branży sprzedaży będzie rodzić potencjalne ryzyko związane z ewentualnymi roszczeniami klientów w odniesieniu do sprzedawanych produktów. Spółka zawiera także umowy handlowe z zewnętrznymi podmiotami, na podstawie których obie strony zobowiązane są do określonych świadczeń. Istnieje w związku z tym ryzyko powstania sporów i roszczeń na tle umów handlowych. Powstałe spory lub roszczenia mogą w negatywny sposób wpłynąć na renomę Spółki, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.2.21 Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi

Spółka zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi. W przypadku ewentualnego zakwestionowania przez organy podatkowe metod określania przez Spółkę warunków rynkowych dla transakcji z podmiotami

powiązanymi istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych dla Spółki konsekwencji podatkowych, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Spółki.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.2.22 Ryzyko praw własności intelektualnej i patentów aplikacyjnych

Technologia Spółki może stanowić bazę dla innych podmiotów do rozwoju pochodnych lub powiązanych technologii. Istnieje ryzyko, że takie podmioty zdecydują się złożyć patenty aplikacyjne bazujące na technologii Spółki, w efekcie czego, do komercyjnego wdrożenia danej technologii konieczne będzie współdziałanie Spółki, jako posiadacza patentu bazowego, z podmiotem trzecim, jako posiadaczem patentu aplikacyjnego. W zakresie praw własności intelektualnej, Spółka korzysta z utworów tworzonych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.2.23 Ryzyko związane z umowami komercjalizacyjnymi

Spółka, ze względu na specyfikę swojej działalności, może stosować różne typy umów komercjalizacyjnych (umowy licencyjne, umowy typu JDA, umowy sprzedaży produktów, umowy typu joint-venture). Nie można jednak wykluczyć ryzyka rynkowego polegającego na nie znalezieniu partnera zainteresowanego zakupem lub komercjalizacją. Na ryzyko rynkowe wpływają również zmieniające się strategie potencjalnych klientów, zmiany wynikające ze zmian w rynkowych trendach a także brak możliwości dotarcia do osób decyzyjnych. Ponadto należy również wziąć pod uwagę ryzyko niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę lub ryzyko niezrealizowania jej zapisów przez Emitenta w związku ze zmaterializowaniem się któregoś z ryzyk opisanych powyżej. Wystąpienie jakiegokolwiek z tych okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, jego wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni

5.18.2.24 Ryzyko wpływu wojny w Ukrainie na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej

Wojna w Ukrainie nie zmieniła modelu działania XTPL. Spółka nie odczuwa wpływu konfliktu na rynek elektroniki drukowanej. Ponadto Spółka:

- nie jest zależna od żadnych dostaw surowców/komponentów z regionów Rosji, Białorusi, Ukrainy;
- nie prowadzi działań sprzedażowych na ww. rynkach. Spółka nie planuje również sprzedaży do ww. krajów w swojej strategii biznesowej;
- nie posiada w kadrze współpracowników z ww. krajów ani współpracowników, którzy pracowali by zdalnie z ww. krajów;
- jest eksporterem głównie w EUR, więc nie jest negatywnie narażona osłabieniem złotówki;
- nie ma informacji od partnerów biznesowych z krajów innych niż ww. o ich planach wprowadzenia zmian w działalności biznesowej, które mogłyby mieć negatywne skutki dla XTPL.

Spółka dostrzega ryzyko wpływu wojny na działalność operacyjną pod kątem wpływu na gospodarkę globalną:

- utrudniona dostępność surowców i związana z tym dostępność materiałów i podzespołów;
- utrudnienia w logistyce dostaw ze względu na ograniczenia w transporcie lotniczym.

W zakresie aktywnych działań pomocowych na rzecz ukraińskich uchodźców wojennych Spółka oraz jej pracownicy podjęli szereg aktywności:

- dodatkowy dzień wolny w miesiącu na wolontariat dla wszystkich pracowników;
- publikacja ogłoszeń o pracę na dedykowanym portalu dla uchodźców ukraińskich;

- zbiórka zabawek oraz najpotrzebniejszych rzeczy dla dzieci z domu dziecka z Ukrainy, które przyjechały do Polski;
- oferowanie domów ukraińskim uchodźcom;
- szycie ubrań dla dzieci z Ukrainy;
- pomoc w sortowaniu darowizn w lokalnych centrach pomocy;
- przekazanie sprzętu komputerowego do centrum zarządzania kryzysowego, które udziela pomocy uchodźcom;
- pomoc w transporcie obywateli Ukrainy z dworca kolejowego do miejsca zakwaterowania;
- wsparcie materialne dla żołnierzy ukraińskich;
- wsparcie finansowe dla zweryfikowanych zbiorów.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni

5.18.2.25 Ryzyko wpływu wojny na Bliskim Wschodzie na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej

Sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie nie spowodowała zmiany w modelu operacyjnym XTPL. Firma nie odczuwa wpływu konfliktu na rynek elektroniki drukowanej. Pomimo posiadania spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych oraz kontaktów biznesowych z firmami działającymi w Izraelu, konflikt nie wpłynął na działalność spółki w tym zakresie.

Spółka na ten moment nie identyfikuje ryzyka wpływu ww. konfliktu na swoją działalność.

Stopień narażenia Emitenta na ryzyko: średni

5.19 ZASADY SPORZĄDZANIA ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5.19.1 Informacja ogólna i podstawa sporządzenia

Śródroczne skrócone sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej XTPL S.A. (jednostkowe i skonsolidowane) obejmują okres 6 miesięcy, zakończony w dniu 30 czerwca 2026 roku i zawierają dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2025 roku oraz zostały sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej roku od Daty Raportu.

Na dzień zatwierdzenia sprawozdań finansowych Zarząd nie stwierdza istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności w opisanym okresie.

Sprawozdania finansowe sporządzono zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ("MSR") 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa oraz zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych.

5.19.2 Waluta sprawozdania

Walutą funkcjonalną i walutą sprawozdawczą sprawozdania finansowego jest złoty polski (PLN), a dane zawarte w sprawozdaniu finansowym zaprezentowane zostały w tysiącach złotych polskich.

5.19.3 Kursy walut zastosowane w sprawozdaniu finansowym

Kursy walut zastosowane w sprawozdaniu finansowym	2026 styczeń - czerwiec		2025 styczeń - czerwiec/ grudzień	
	EUR	USD	EUR	USD
dla pozycji bilansowych	4,2963	3,7708	4,2267	3,6016
dla pozycji wynikowych i przepływów pieniężnych	4,2522	3,6526	4,2208	3,8422

5.19.4 Opis istotnych zasad rachunkowości

Przy sporządzeniu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego zastosowano te same zasady rachunkowości co w sprawozdaniu finansowym za rok 2025 opublikowanym w dniu 29 kwietnia 2026 roku, a także w ostatnim kwartalnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 marca 2026 roku (raport za I kwartał 2026 z dnia 27 maja 2026 roku). W Okresie Sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany zasad (polityki) rachunkowości, ani istotne zmiany wielkości szacunkowych.

6. AKCJONARIAT

6.1 Znaczące pakiety akcji

Struktura akcjonariatu na Datę Bilansową była następująca (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu):

L.p.	Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	% wszystkich akcji	Liczba głosów	% wszystkich głosów
1.	Deutsche Balaton AG	437 042	14,82%	437 042	14,82%
2.	Dr Filip Granek	333 498	11,31%	333 498	11,31%
3	Esaliens TFI SA	303 809	10,30%	303 809	10,30%
4	ACATIS Investment	291 742	9,89%	291 742	9,89%
5	Leonarto Funds	267 564	9,07%	267 564	9,07%
6	Pozostali	1 316 222	44,62%	1 316 222	44,62%
	RAZEM	2 949 877	100,0%	2 949 877	100,0%

* Deutsche Balaton AG oraz Heidelberger Beteiligungsholding AG

Struktura akcjonariatu na Datę Raportu była następująca (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu):

L.p.	Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	% wszystkich akcji	Liczba głosów	% wszystkich głosów
1.	Deutsche Balaton AG	437 042	14,82%	437 042	14,82%
2.	Dr Filip Granek	333 498	11,31%	333 498	11,31%
3	Esaliens TFI SA	303 809	10,30%	303 809	10,30%
4	ACATIS Investment	291 742	9,89%	291 742	9,89%
5	Leonarto Funds	267 564	9,07%	267 564	9,07%
6	Pozostali	1 316 222	44,62%	1 316 222	44,62%
	RAZEM	2.949 877	100,0%	2.949 877	100,0%

Od dnia przekazania przez Emitenta poprzedniego raportu okresowego, tj. przekazania raportu okresowego za pierwszy kwartał 2026 rok w dniu 27 maja 2026 roku nie miały miejsca żadne zmiany w zakresie własności znacznych pakietów.

6.2 Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

L.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Stan posiadania na dzień 30 czerwca 2026	Stan posiadania na Datę Raportu
1.	Dr Filip Granek	Prezes Zarządu	333 498	333 498
2.	Jacek Olszański	Członek Zarządu	9 250	9 250
3.	Dr Wiesław Rozłucki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	-
4.	Dr hab. Bartosz Wojciechowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	1 350	1 350
5.	Prof. dr hab. Herbert Wirth	Członek Rady Nadzorczej	-	-
6.	Piotr Lembas	Członek Rady Nadzorczej	-	-
7.	Beata Turlejska	Członek Rady Nadzorczej	-	-

Od dnia przekazania przez Emitenta poprzedniego raportu okresowego, tj. przekazania raportu okresowego za pierwszy kwartał 2026 rok w dniu 27 maja 2026 roku nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta.

7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd XTPL S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy śródroczne skrócone jednostkowe oraz śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta i grupy kapitałowej XTPL S.A. oraz ich wynik finansowy. Ponadto Zarząd XTPL S.A. oświadcza, że półroczne sprawozdanie z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji XTPL S.A. i grupy kapitałowej Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Filip Granek
Prezes Zarządu

Jacek Olszański
Członek Zarządu

Wrocław, 28 września 2026 roku

8. RAPORT Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Raport firmy audytorskiej z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL S.A. stanowi załącznik do Raportu.

9. STANOWISKO ZARZĄDU

Nie dotyczy. Firma audytorska nie wyraziła opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej ani nie dokonała odmowy wyrażenia opinii o jednostkowym ani skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym XTPL S.A. oraz grupy kapitałowej XTPL S.A.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Filip Granek
Prezes Zarządu

Jacek Olszański
Członek Zarządu

Wrocław, 28 września 2026 roku

10. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE FIRMY AUDYTORSKIEJ UPRAWNIONEJ DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd XTPL S.A. oświadcza, że firma audytorska uprawniona do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Filip Granek
Prezes Zarządu

Jacek Olszański
Członek Zarządu

Wrocław, 28 września 2026 roku

11. ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACJI

Raport za pierwsze półrocze 2026 roku zakończone 30 czerwca 2026 roku został zatwierdzony do publikacji przez Zarząd Emitenta w dniu 28 września 2026 roku.

Podpisy:

Filip Granek
Prezes Zarządu

Jacek Olszański
Członek Zarządu

Wrocław, dnia 28 września 2026 roku